证券简称：中富电路　　证券代码：300814

深圳中富电路股份有限公司

SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED

（广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号）

向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层）

二〇二六年九月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要风险提示。

一、特别风险提示

（一）募投项目效益未达预期的风险

公司董事会已对本次募投项目的可行性展开充分论证。依据项目可行性研究报告，鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目在运营期内预计年均营业收入为 70,044.44 万元，年均净利润达 8,576.81 万元。该可行性分析系基于当前市场环境、既有技术水平及对行业发展趋势的判断而制定，但项目推进过程中，仍可能因宏观政策与市场环境出现不利变化、PCB 行业竞争态势加剧、关键技术发生重大迭代、新增产能消化不及预期、AI 基础设施建设节奏放缓等因素，导致募投项目延期实施或无法达到预期效益。

当前全球经济复苏前景尚存不确定性，地缘政治形势依然复杂多变。若未来下游 AI 领域需求增速不达预期，PCB 行业竞争可能进一步激化，募投项目新增产能将面临消化压力；同行业上市公司或采取降价策略争夺订单，进而压缩行业整体利润空间。此外，本次募投项目将新增较多固定资产，预计达产后新增折旧摊销金额将对公司利润水平产生一定影响。因此，若未来新增产能消化不足或产品价格下行，募投项目的效益实现将受到制约。同时，在项目实施过程中，亦可能因经营风险、意外事故或其他不可抗力因素，造成投资周期延长、成本超支、投产延迟等情况，从而引致募投项目实际收益不及预期的风险。

（二）项目投产后的产能消化风险

报告期内，公司产能利用率分别为 73.18%、87.38%、82.13%和 90.49%。考虑到产线排期、设备例行检修以及新建泰国工厂尚处于产能爬坡阶段等因素，公司整体产能利用率维持在较高水平。同期，公司产品产销率分别为 98.89%、91.80%、92.24%和 95.07%，公司产品销售态势良好。由于前次可转债募投项目泰国工厂已于 2025 年初投产，尚处于产能爬坡阶段，本次募投项目投产后将新增年产 12 万平方米印制电路板产能，公司未来产能增长较快。若 PCB 市场增

速或下游客户开拓进展不及预期，则公司现有及拟建产能将面临一定的消化风险。

（三）原材料价格波动风险

公司原材料成本占总成本比重较高，报告期内，直接材料占主营业务成本的比例约为 58.14%，其采购价格对主营业务成本具有显著影响。公司生产所需主要原材料涵盖覆铜板、铜箔、铜球、半固化片及金盐等，上述材料价格受铜、石油、黄金等大宗商品市场行情波动影响较大。近年来，受全球经济形势及国际政治局势变动影响，国际铜价、金价及石油价格出现较大幅度波动，公司主要原材料采购价格亦随之呈现明显波动。若未来主要原材料采购价格持续上涨，而公司无法通过向下游客户传导、工艺技术创新、产品结构优化等方式有效应对成本上升压力，则公司盈利水平将面临不利影响。

（四）业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 124,112.76 万元、145,398.48 万元、187,912.99 万元和 117,207.60 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2,626.93 万元、3,809.43 万元、2,914.44 万元和 3,861.86 万元。2025 年，受泰国工厂产能爬坡、研发投入加大及原材料价格上涨等因素影响，公司归母净利润同比有所下降。公司经营业绩受下游市场需求变化影响较大，若未来宏观经济表现疲弱，相关行业政策或技术发生重大不利调整，或泰国工厂未能实现预期经济效益，抑或国际贸易摩擦、地缘政治冲突持续恶化，均可能对公司盈利能力造成较大冲击。在个别极端情形或多项风险叠加的情况下，发行人存在发行当年业绩下滑的可能性。

（五）募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险

本次募投项目涉及大额设备采购及建设工程等资本性支出，项目建成投产后，公司每年将新增较高金额的折旧摊销费用。根据测算，本次募投项目预计每年新增折旧摊销费用最高为 6,891.38 万元，将对公司利润总额产生一定影响。尽管公司已对募投项目进行了充分的可行性论证，并根据效益预测确认新增收益足以覆盖上述折旧摊销费用，但项目实际收益受宏观经济、产业政策、市场环境、行业竞争格局及技术迭代等多重因素影响。若未来项目效益未能达到预

期水平，新增折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

（六）应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,157.45 万元、37,941.44 万元、45,350.13 万元和 56,561.35 万元，占各期营业收入的比例依次为 24.30%、26.09%、24.13%和 24.13%（已年化处理），其中账龄一年以内的应收账款占比在 98%以上，发生坏账的风险较小。公司应收账款余额随业务规模的扩大呈不断增加的趋势，若下游客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。

（七）存货规模较大及跌价风险

报告期内随着公司经营规模的扩大，公司存货规模上升较多。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 29,819.05 万元、41,452.15 万元、57,748.88 万元和 65,209.42 万元，占公司总资产的比例分别为 13.18%、13.88%、17.65%和 19.60%。2025 年末、2026 年 6 月末存货账面价值占总资产比例增加主要系公司泰国工厂新建产能增加以及原材料价格上涨所致。若未来公司主要原材料和产品价格在短期内发生大幅下降，或因国家政策和市场需求造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品难以在短期内实现销售，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值，届时需计提存货跌价准备，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

二、本次向特定对象发行股票情况

1、公司已于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过本次发行的相关议案。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证

券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调整。

本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东会授权在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据市场询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

4、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 57,429,039 股（含本数），即不超过本次发行前总股本的 30%，且募集资金总额不超过 84,400.00 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 84,400.00 万元（含本数，已扣除本次发行首次董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 600.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目	74,020.52	60,000.00
2	数字化升级建设项目	12,763.01	8,000.00
3	补充流动资金	16,400.00	16,400.00
合计		**103,183.53**	**84,400.00**

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

6、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

7、本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

8、本次发行完成后，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按本次发行完成后的持股比例共享。

9、本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。

三、前次募集资金使用情况

公司前次发行包括 2021 年首次公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券，截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金已全部按计划

使用完毕，募集资金专户已注销。

目 录

声 明 **1**
重大事项提示 **2**
一、特别风险提示 2
二、本次向特定对象发行股票情况 4
三、前次募集资金使用情况 6
目 录 **8**
释 义 **10**
一、一般术语 10
二、专业术语 12
第一节 发行人基本情况 **15**
一、发行人基本信息 15
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 21
四、公司主营业务的基本情况 50
五、现有业务发展安排及未来发展战略 57
六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 60
七、诉讼、仲裁及行政处罚情况 66
八、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况 68
第二节 本次证券发行概要 **69**
一、本次发行的背景和目的 69
二、发行对象及与发行人的关系 72
三、本次向特定对象发行股票方案概况 72
四、本次发行是否构成关联交易 75
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 75
六、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 75
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 **77**
一、本次募集资金使用计划 77
二、本次募集资金投资项目的具体情况 77
三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 95
四、本次发行董事会决议日距前次募集资金到账的时间间隔 97
五、关于主营业务与募集资金投向的合规性 97
六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 99

第四节 历次募集资金运用 100
一、最近五年内募集资金情况 100
二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 106
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 107
一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的影响 107
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 108
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 109
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 109
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 109
第六节 与本次发行相关的风险因素 110
一、与发行人相关的风险 110
二、与行业相关的风险 115
三、其他风险 117
第七节 与本次发行相关的声明 118
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 118
二、审计委员会声明 119
三、控股股东声明 120
四、实际控制人声明 125
五、保荐机构（主承销商）声明 126
六、发行人律师声明 129
七、发行人会计师声明 130
八、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 132
附表：专利 137

释 义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

发行人、公司、股份公司、本公司、中富电路	指	深圳中富电路股份有限公司
中富有限	指	深圳中富电路有限公司，本公司前身
鹤山中富	指	鹤山市中富兴业电路有限公司，本公司全资子公司，亦称“鹤山工厂”
聚辰电路	指	聚辰电路有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司
聚臻电子	指	聚臻电子有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司
聚慧电子	指	聚慧电子有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司
聚辰泰国、WTT	指	聚辰电子（泰国）有限公司，英文名称 WTT Electronics Co.,Ltd，公司在泰国设立的全资子公司
中富盈创	指	深圳中富盈创电路科技有限公司，公司控股子公司
松岗分厂	指	深圳中富电路股份有限公司松岗分厂，本公司分支机构，亦称“松岗工厂”
南山分公司	指	深圳中富电路股份有限公司南山分公司，本公司分支机构
沙井工厂	指	本公司在沙井设立的工厂
实际控制人	指	王昌民、王璐、王先锋
中富电子	指	中富电子有限公司，本公司控股股东之一
睿山科技	指	深圳市睿山科技有限公司，本公司控股股东之一
香港慧金	指	香港慧金投资有限公司，本公司控股股东之一
泓锋实业	指	深圳市泓锋实业发展有限公司，本公司控股股东之一
中富兴业	指	深圳市中富兴业电子有限公司，本公司控股股东之一
泓众投资	指	东莞市泓众投资有限公司，控股股东深圳市泓锋实业发展有限公司分立新设的一致行动人
共同控股股东	指	中富电子、睿山科技、香港慧金、泓锋实业、中富兴业
本次发行	指	本公司按照募集说明书向中国境内投资者发售的股票，将在深圳证券交易所上市之事宜
银方新材	指	厦门银方新材料科技有限公司，本公司参股公司
迈威科技	指	深圳市迈威科技有限公司，本公司参股公司
中为封装	指	中为先进封装技术（深圳）有限公司，本公司参股公司

ECC	指	Electronic Composite Company Limited，本公司控股股东中富电子在香港投资的参股公司
聚源新材	指	深圳聚源新材科技有限公司，ECC 控股子公司
生益科技	指	广东生益科技股份有限公司
南亚新材	指	南亚新材料科技股份有限公司
华正新材	指	浙江华正新材料股份有限公司
江南新材	指	江西江南新材料科技股份有限公司
联茂电子	指	东莞联茂电子科技有限公司、广州联茂电子科技有限公司
景旺电子	指	深圳市景旺电子股份有限公司
深南电路	指	深南电路股份有限公司
依顿电子	指	广东依顿电子科技股份有限公司
世运电路	指	广东世运电路科技股份有限公司
沪电股份	指	沪士电子股份有限公司
科翔股份	指	广东科翔电子科技股份有限公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
博敏电子	指	博敏电子股份有限公司
满坤科技	指	吉安满坤科技股份有限公司
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司
骏亚科技	指	广东骏亚电子科技股份有限公司
奥士康	指	奥士康科技股份有限公司
生益电子	指	生益电子股份有限公司
臻鼎科技、臻鼎	指	臻鼎科技控股股份有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯（000063.SZ）及其控制的关联方
Asteelflash	指	Asteelflash Group S.A.，飞旭集团，欧洲 EMS 厂商
NCAB	指	NCAB Group，全球 PCB 贸易商
Schneider	指	Schneider Electric SE（施耐德电气）及其关联方，能源电力企业
Lacroix	指	Lacroix Electronics，欧洲知名 EMS 厂商
VERTIV	指	维谛技术有限公司及其关联方，美国证券交易所上市公司
Lenze	指	德国 Lenze 公司及其关联方，机械制造、自动化公司
Plexus	指	Plexus Corp.，美国 EMS 公司及其关联方
伟创力	指	Flextronics，全球知名 EMS 厂商
嘉龙海杰	指	东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司
富特科技	指	浙江富特科技股份有限公司

威迈斯	指	深圳威迈斯新能源股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
保荐机构、保荐人、主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳中富电路股份有限公司章程》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
报告期/最近三年一期	指	2023 年、2024 年、2025 年、2026 年 1-6 月

二、专业术语

印制电路板、PCB	指	英文名称“Printed Circuit Board”，即采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是电子元器件的支撑体和电气连接载体，又可称为“印制线路板”、 “印刷线路板”。
单面板	指	英文名称“Single-Sided Boards”，即仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB。
双面板	指	英文名称“Double-Sided Boards”，即在基板两面形成导体图案的 PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连。
多层板	指	英文名称“Multi-Layer Boards”，即具有更多层导电图形的 PCB（通常层数都是偶数），生产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔（via）互联。
小批量板	指	订单面积小于 50 平方米的产品认定为小批量产品。
大批量板	指	订单面积在 50 平方米以上的产品认定为大批量产品。
高多层、高多层板	指	具有多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有导通孔互连，公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板。

刚性电路板、刚性板	指	英文名称“Rigid PCB”，即由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点为可以附着上的电子元件提供一定支撑。
刚挠结合板	指	英文名称“Rigid-flex PCB”，即将刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板。使得一块 PCB 上包含一个或多个刚性区和柔性区，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性。
高密度互连电路板、HDI 板	指	英文名称“High Density Interconnection”，即高密度互连技术。HDI 是印制电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点。
EMS	指	英文名称“Electronic Manufacturing Services”，即电子制造服务。EMS 就是一个全线的服务，包括产品开发设计、产品生产、原材料采购、产品品质管理及物流运输等一系列服务。
基板、基材	指	制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两大类。
覆铜板	指	由铜箔、树脂、补强材料及其它功能补强添加物组成的刚性电路板加工基材。
半固化片	指	一种用于制作多层板的、主要由树脂和增强材料组成的主要材料。其中增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型，目前制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料。
沉铜	指	英文名称“Plating Through Hole”，即在已钻孔的不导电的孔壁基材上，用化学方法沉积一层薄薄的化学铜，以作为后面电镀铜的基底。
电镀	指	英文名称“Vertical conveyor plating”，即垂直连续电镀，采用喷射镀铜工艺及垂直连续输送装置，比传统悬吊式（龙门）电镀品质大幅提升。
压合	指	制作多层板的一个重要工序，将铜箔、胶片与氧化处理后的内层线路板叠加后压制成多层基板。
过孔	指	英文名称“Via hole”，即在双面板和多层板中，为连通各层之间的印制导线，在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔，即过孔，又可称为金属化孔。过孔一般又分为三类：盲孔、埋孔和通孔。
蚀刻	指	将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术，通过曝光、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用。
涂布	指	为了防腐、绝缘、装饰等目的，以液体或粉末形式在织物、纸张、金属箔或板等物体表面上涂盖塑料薄层。
棕化	指	对生产板进行铜面处理，在内层铜箔表面生成一层氧化层以

		提升多层线路板在压合时铜箔和环氧树脂之间的接合力。
导线	指	英文名称“Conductor trace line”，即用于连接元器件引脚，传递电流信号，实现电路物理连接的电气网络铜膜，又可称为铜膜走线。导线的布置对整个印刷电路板的性能有直接影响，是印刷电路板设计的核心。
内埋工艺	指	将有源或无源器件如芯片、电感、电容、电阻嵌入 PCB/载板内部
PSIP	指	英文名称“Power System in Package”，是一种将多个电源管理芯片集成在一起的封装技术，内部集成了电源 IC、电感、电容及其他无源器件，核心在于通过高度集成的小型化技术实现紧凑型电源管理解决方案。
E-mapping	指	全称 Electronic-Mapping，电子缺陷坐标映射，PCB/IC 载板高端检测工艺，用于追踪晶圆或 PCB 板上每个单元（如 die、PCS）在制造全流程中的位置、状态和良率数据
VMI	指	供应商管理库存模式，英文名称“Vendor Managed Inventory”，即供应商在客户的要求下将货物运送至客户指定仓库，并根据客户需求维护库存水平，客户领用之前的货物仍归供应商所有。
oz	指	盎司，PCB 铜箔面密度单位，1oz 指 1 平方英尺铜箔质量为 1 盎司，对应铜箔理论厚度约 35μm。
5G	指	第五代移动通信技术的简称，以全新的网络架构，提供至少十倍于 4G 的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，实现网络性能新的跃升。
CPCA	指	英文名称“China Printed Circuit Association”，即中国电子电路行业协会。CPCA 是中国工业和信息化部业务主管、民政部批准成立的国家一级行业协会。
WECC	指	英文名称“World Electronic Circuits Council”，即世界电子电路联盟，是由全球各电路板产业协会所组成的跨国组织。
Prismark	指	Prismark Partners LLC，是一家印制电路板领域内的知名市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力。
一次电源板	指	将外部交流电 AC 或高压 DC 转换为服务器内部直流母线电压，属于一级能量转换环节；产品功率等级高，对散热设计与绝缘耐压要求较高。
二次电源板	指	将一次电源输出的直流母线电压转换为中间电压，属于二级能量分配环节，侧重保障电压输出稳定性与功率传输效率。
三次电源板	指	将中间电压进一步降压至芯片级工作电压，直接为 GPU、CPU、ASIC 等核心芯片供电，属于末端精准调压环节，强调高频动态响应能力与小型化集成设计。

注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称	深圳中富电路股份有限公司
英文名称	SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED
成立日期	2004 年 3 月 12 日
上市日期	2021 年 8 月 12 日
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码	9144030075568456XX
法定代表人	王昌民
注册资本	19,143.01 万元
注册地址	广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	中富电路
股票代码	300814.SZ
董事会秘书	王家强
邮政编码	518067
互联网网址	www.jovepcb.com
电子邮箱	ir@jovepcb.com
电话号码	86-755-26683724
传真号码	86-755-26406673
经营范围	双面及多层线路板、柔性线路板的生产和销售；技术及货物进出口（不含分销、国家专营专控商品）；生产经营新型电子元器件（频率控制与选择元件）--高频微波线路板、半导体专用材料（半导体载板）的生产及销售（上述增营项目在松岗分厂生产）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人股权结构

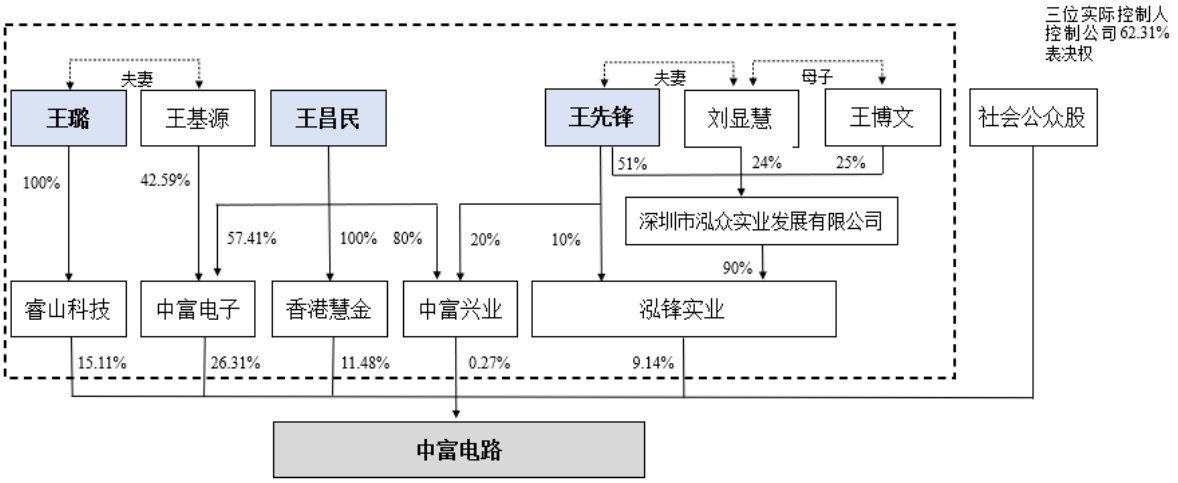
1、股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	-	-
其中：高管锁定股	-	-
二、无限售条件流通股	191,430,132	100.00%
三、总股本	**191,430,132**	**100.00%**

2、公司股权结构情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股权控制关系如下图[1]：



3、前十大股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量
1	中富电子有限公司	境外法人	50,369,696	26.31	-	-
2	深圳市睿山科技有限公司	境内一般法人	28,927,700	15.11	-	-
3	香港慧金投资有限公司	境外法人	21,967,000	11.48	-	-
4	深圳市泓锋实业发展有限公司	境内一般法人	17,493,800	9.14	-	-

[1] 注：2025 年 8 月发行人控股股东之一泓锋实业因自身发展需要分立为泓锋实业（存续公司）和泓众投资（新设公司），截至 2026 年 6 月 30 日该分立事项仍在进行中。

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量
5	张东东	境内自然人	1,694,151	0.88	-	-
6	厦门市聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1,179,900	0.62	-	-
7	香港中央结算有限公司	境外法人	997,846	0.52	-	-
8	J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	891,265	0.47	-	-
9	中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	735,800	0.38	-	-
10	交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品	726,400	0.38	-	
合计			**124,983,558**	**65.29**	**-**	**-**

（二）控股股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东中富电子、中富兴业、睿山科技、香港慧金、泓锋实业合计持有公司 62.31%的股份，具体情况如下：

1、中富电子

公司名称	中富电子有限公司
英文名称	JOVE ENTERPRISE LIMITED
公司住所	SUITE F, 4TH FLOOR, YIP CHEUNG CENTRE, 10 FUNG YIP STREET, CHAI WAN, HONG KONG
注册资本	10 万港元
实收资本	10 万港元

股东构成	王昌民持股 57.41%、王基源持股 42.59%
成立日期	2003 年 2 月 28 日
与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，为本公司控股股东之一，与公司主营业务无关

2、睿山科技

公司名称	深圳市睿山科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FRG4G79
公司住所	深圳市南山区招商街道沿山社区 3 兰溪谷二期 3B 栋 4C
法定代表人	王璐
注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
股东构成	王璐持股 100%
成立日期	2019 年 8 月 27 日
经营范围	电子产品及新材料的研发制造
与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，为本公司控股股东之一，与公司主营业务无关

3、泓锋实业

公司名称	深圳市泓锋实业发展有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FRCMA14
公司住所	深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路 0101 号丽湾商务公寓 B-507
法定代表人	王先锋
注册资本	300 万元
实收资本	50 万元
股东构成	深圳市泓众实业发展有限公司持股 90%，王先锋持股 10%
成立日期	2019 年 8 月 23 日
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；信息科技、电子产品及相关材料与设备的研发、技术咨询、技术服务；为产业园提供管理服务；自有物业租赁；经济信息咨询；国内贸易。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，为本公司控股股东之一，与公司主营业务无关

4、香港慧金

公司名称	香港慧金投资有限公司
英文名称	HJ INVESTMENT LIMITED
公司住所	SUITE F, 4TH FLOOR, YIP CHEUNG CENTRE, 10 FUNG YIP STREET, CHAI WAN, HONG KONG
注册资本	10 万港元
实收资本	10 万港元
股东构成	王昌民持股 100%
成立日期	2019 年 8 月 8 日
与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，为本公司控股股东之一，与公司主营业务无关

5、中富兴业

公司名称	深圳市中富兴业电子有限公司
统一社会信用代码	91440300729855943R
公司住所	深圳市南山区粤海街道龙城社区南商路 80 号钜建大厦龙泉阁 8F
法定代表人	王昌民
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
股东构成	王昌民持股 80%、王先锋持股 20%
成立日期	2001 年 6 月 23 日
经营范围	投资兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。
与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，为本公司控股股东之一，与公司主营业务无关

（三）实际控制人情况

2019 年 8 月，王昌民、王璐、王先锋签署《一致行动协议》，对中富有限自设立以来的共同控制关系予以确认，并约定自协议签署之日起至公司上市后第 100 个月内保持一致行动。截至 2026 年 6 月 30 日，三人通过中富电子、中富兴业、睿山科技、泓锋实业及香港慧金等主体合计间接控制发行人 62.31%股份，为公司实际控制人。三位实际控制人简历如下：

王昌民先生，1964 年 3 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东青岛化工学院讲师；1987 年 9 月至 1990 年 5 月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990 年 5 月至 1998 年 4 月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998 年 5 月至 1999 年 3 月，就职于华侨兴业发展股份有限公司；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于深圳市昌本电子有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任深圳市中富兴业电子有限公司执行董事、总经理；2004 年 3 月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事、香港慧金董事、ECC 董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、迈威科技董事。2023 年 8 月至今兼任中富盈创董事长。2023 年 10 月至今，任深圳聚源新材科技有限公司董事。

王璐女士，1964 年 7 月出生，中国香港居民，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992 年 7 月至 1995 年 5 月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995 年 5 月至 1999 年 6 月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，任深圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任中富兴业监事；2004 年 3 月至 2019 年 11 月，历任公司销售负责人、副董事长；2019 年 12 月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、鹤山中富兴业监事、睿山科技执行董事、总经理。2022 年 5 月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。2023 年 8 月至今兼任中富盈创董事。

王先锋先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1987 年 9 月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990 年 3 月至 1999 年 5 月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999 年 5 月至 2001 年 4 月，任广州普林电路有限公司总经理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任中富兴业管理部总经理；2004 年 3 月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董事、总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理，现兼任深圳市泓锋实业发展有限公司董事。

截至本募集说明书签署日，王昌民、王璐、王先锋合计间接持有公司 62.31%股份，为公司共同实际控制人。报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

（四）实际控制人报告期内被采取监管措施情况

2023 年 10 月 19 日，发行人董事王先锋收到深圳证监局下发的《关于对王先锋采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕188 号），提出“你担任深圳中富电路股份有限公司董事、总经理期间，你的配偶于 2023 年 2 月 10 日买入公司股票 5,000 股，又于 2023 年 2 月 13 日累计卖出公司股票 5,000 股”，对此深圳证监局决定对公司董事兼总经理王先锋采取出具警示函的监管措施。发行人及相关人员收到上述行政监管措施决定书后高度重视，并严格按监管要求积极整改。

除上述情况外，发行人报告期内不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取行政处罚或监管措施的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）行业监管体制和主要产业政策

公司主营业务为印制电路板（Printed Circuit Board）的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”；根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”项下的“新型电子元器件及设备制造”行业。

1、主管部门

（1）行业主管部门

工信部作为印制电路板行业的主管部门，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、通信业及信息化发展规划，推进产业结构战略性调整与优化升级，促进信息化与工业化融合，推动军民结合型武器装备科研生产体系建设；同时负责制

定并实施工业、通信业行业规划、计划及产业政策，提出产业布局与结构优化建议，起草相关法律法规草案及规章，拟订行业技术规范与标准并监督执行，指导行业质量管理等工作。

（2）行业自律性协会

中国电子电路行业协会（CPCA）是 PCB 行业的自律组织，由电子电路（PCB）、覆铜薄板（CCL）、原辅材料、专用设备及电子装联（SMT）和电子制造服务（EMS）企业以及相关科研院校自愿结成的全国性、行业性社会团体。中国电子电路行业协会主要职责包括：开展对本行业的基础资料和市场的调查、搜集、统计、整理和交流工作，并积极向政府部门提出制定行业规划、经济和技术政策、技术标准及经济立法等方面的建议，及时向有关部门和会员单位提供情况、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作等。

2、公司所属行业的产业政策

印制电路板是连接各类元器件组件的关键部件，亦是现代电子设备的重要组成部分。电子信息产业作为我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，其基础产品印制电路板获得了国家一系列产业政策的扶持与鼓励，旨在推动行业产业升级及战略性调整。具体政策如下：

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	国务院	2026 年	推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料；围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设和集约高效利用；壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
2	《电子信息制造业发展“十五五”规划》	工业和信息化部	2026 年	到 2030 年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
				产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破 30 万亿元。产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。
3	《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》	工业和信息化部	2026 年	目标到 2026 年底，全国服务商资源池内服务商数量突破 2000 家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强。
4	《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》	工业和信息化部等八部门	2026 年	支持大型企业深化应用部署，提升设备上云、关键工序数控化和经营管理数字化水平，“一业一策”制定推广电子信息等行业融合应用指南，助力制造业数字化转型和传统产业改造提升。
5	《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》（征求意见稿）	工业和信息化部	2025 年	明确印制电路板行业在产业布局、生产规模、工艺技术、质量管理、智能制造、绿色制造及资源环境保护等方面的引导性要求，鼓励企业提升研发投入与人均产值，设定刚性板、HDI 板、挠性板、刚挠结合板等产品的关键加工能力指标，推动自动化、数字化与绿色化升级，促进行业向高端化、集聚化、可持续发展方向转型。
6	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	工业和信息化部、市场监督管理总局	2025 年	支持汽车电子、海洋电子、航空电子、医疗电子等产业发展，助推产业数字化转型、智能化升级。推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设，提升智算云服务水平，赋能科学研究、自动驾驶、生物医药等高算力场景。
7	《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	中共中央	2025 年	推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
				企业组织形态变革。增强质量技术基础能力，强化标准引领、提升国际化水平，加强品牌建设。
8	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	2025年	该文件指出，到 2027 年率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。
9	《机械工业数字化转型实施方案》	工业和信息化部等八部门	2025年	旨在研制一批智能装备、建设一批智能工厂、拓展一批智慧服务，推动机械工业高端化、智能化、绿色化发展，为推进新型工业化提供坚实的技术装备保障。
10	《推动工业领域设备更新实施方案》	工信部等七部门	2024年	聚焦电子行业更新高速精密贴装、先进焊接等设备，强化电路板制造能力；同时构建“云边端”算力协同体系，部署工业边缘数据中心与智算中心，提升算力供给与跨域调度效率，支撑制造业数字化转型。
11	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	工业和信息化部	2024年	提出以电子元器件及电子材料生产检测设备的自动化、智能化、柔性化、节能化改造为重点，推动电子元器件产品向集成化、高频化、高精度、高可靠发展，加快微型化、高频化产品研发。
12	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部等七部门	2024年	重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，下游应用领域的拓展将推动 PCB 产业升级扩容。
13	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发展和改革委员会	2023年	将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线

序号	名称	发布机构	发布时间	主要内容
				宽/线距≤0.05mm）柔性电路板”列为“鼓励类”产业。
14	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	2023年	提出2023至2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元，推动电子信息制造业包括PCB行业的稳定增长。

（二）行业发展概况

1、印制电路板简介

印制电路板（PCB）是指在通用基材上按预定设计形成点间连接与印制组件的印制板，主要由绝缘基材和导体材料构成，其核心功能是实现电子零组件间的电路连接与中继传输。作为电子元件装载基板与关键互连件，PCB的制造质量直接影响电子产品的可靠性与系统级竞争力，因而被称为“电子系统产品之母”。PCB行业是电子信息产品制造的基础，其应用覆盖AI基础设施、汽车电子、消费电子、工业控制、通信电子、医疗健康、航空航天、军事及半导体等广泛下游领域。

2、印制电路板的分类

印制电路板行业分类方法较多，结合产品主要特点和通用的分类方法，印制电路板可以分为以下类别：

产品种类			产品特征	应用领域
刚性板	单面板		最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上	普通家电、电子遥控器和简单的电子产品等
	双面板		在基材的两面都有布线，两面间有适当电路连接，可以用于较复杂的电路上	消费电子、计算机、汽车电子、通信设备、工业控制等
	多层板		四层及以上导电图形与绝缘材料压制而成，层间导电图形通过导孔进行互连	消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、军工、航空航天等
	特	HDI板	高密度互连（High Density Interconnect）	智能手机、平板电脑、

产品种类			产品特征	应用领域
	种板		板，具有高密度化、精细导线化、微小孔径化等特性，HDI 板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印制电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接	通信设备、计算机、汽车电子、工业控制、医疗设备等
		厚铜板	任何一层铜厚为 2oz 及以上的印制电路板，厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热性能，厚铜板由于线路铜厚较厚，对压合层间粘结剂填胶、钻孔、电镀等工艺要求较高	工业电源、军工电源、发动机设备等
		高频板	高频板是指使用特殊的低介电常数、低信号损耗材料生产出来的印制电路板，具有较高的电磁频率。一般来说，高频可定义为频率在 1GHz 以上。高频板对信号完整性要求较高，材料加工难度较大，具体体现在对图形精度、层间对准度和阻抗控制方面要求更为严格	通信基站、服务器/存储器、微波传输、卫星通信、导航雷达等
		高速板	高速板是由低信号损耗的高速材料压制而成的印制电路板，主要承担芯片组间与芯片组与外设间高速电路信号的数据传输、处理与计算，以实现芯片的运算及信号处理功能。高速板对精细线路加工及特性阻抗控制技术及插入损耗控制要求较高	通信和服务器、存储器、交换机等领域
		金属基板	由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板，金属基板具有散热性好、机械加工性能佳等特点，主要应用于发热量较大的电子系统中	汽车电子、通信无线基站、微波通信等
		内埋器件板	是将电子元件嵌埋至线路板内部，从而使电路板模块具有小型化，缩短元件之间的连接路径，降低传输损失等优点	便携电子设备、消费电子、汽车等
挠性板			简称软板或 FPC，以柔性绝缘基材制成的印制电路板，具有轻薄、可弯曲的特点	智能手机、医疗设备、便携式电子设备、可穿戴智能设备等
封装基板			又称“IC 载板”，直接用于搭载芯片，可为芯片提供封装、电连接、保护、散热等功能	各类电子设备的芯片封装

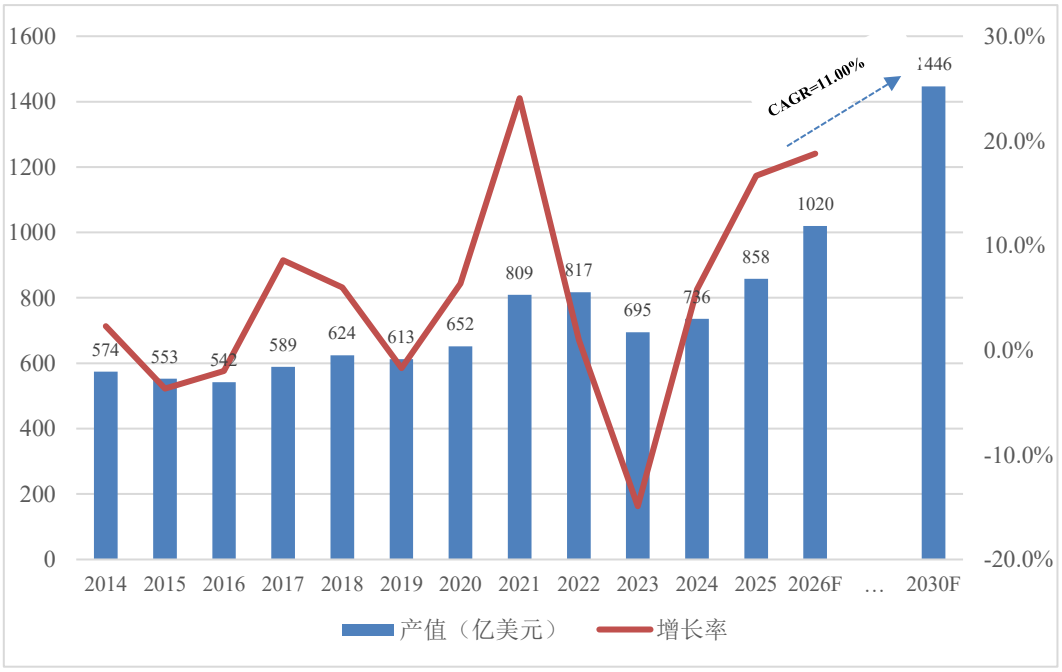
3、行业发展概况及发展前景

（1）全球印制电路板市场概况

1）市场规模

PCB 广泛应用于 AI 基础设施、汽车电子、消费电子、通信电子、计算机、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件。根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 产业总产值为 858.36 亿美元，同比增长 16.68%。在智能化、低碳化趋势推动下，人工智能、新能源汽车、5G/6G 通信、物联网及智能终端等下游应用将持续扩张，带动 PCB 需求稳步增长。Prismark 预计，2030 年全球 PCB 产值将达 1,446.11 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率约为 11.00%。

2014-2030 年全球 PCB 产值及增长率（亿美元）



数据来源：Prismark

2）全球 PCB 产业分布

近年来凭借中国大陆、中国台湾及东南亚在劳动力、资源、政策及产业集聚等方面的综合优势，全球电子制造业产能持续向亚洲地区转移，形成了以中国大陆、中国台湾、东南亚等地为制造中心的产业格局。2006 年，中国大陆超越日本成为全球第一大 PCB 生产地区，产量与产值均居世界首位。此后，亚洲地区在全球 PCB 市场的主导地位进一步巩固，自 2013 年以来，亚洲 PCB 产量占全球比重已超过 90%，中国自 2016 年起全球产量占比超过 50%，并持续保

持领先。近年来，在下游电子行业产业转移的带动下，东南亚地区（主要是泰国、越南、马来西亚）基于税收、政策、物流、人工等优势，承接了来自全球的大量 PCB 产业转移，因此东南亚地区 PCB 产值保持较高增速。

2025-2030 年全球 PCB 产值年均复合增长率预测（按地区）

单位：亿美元

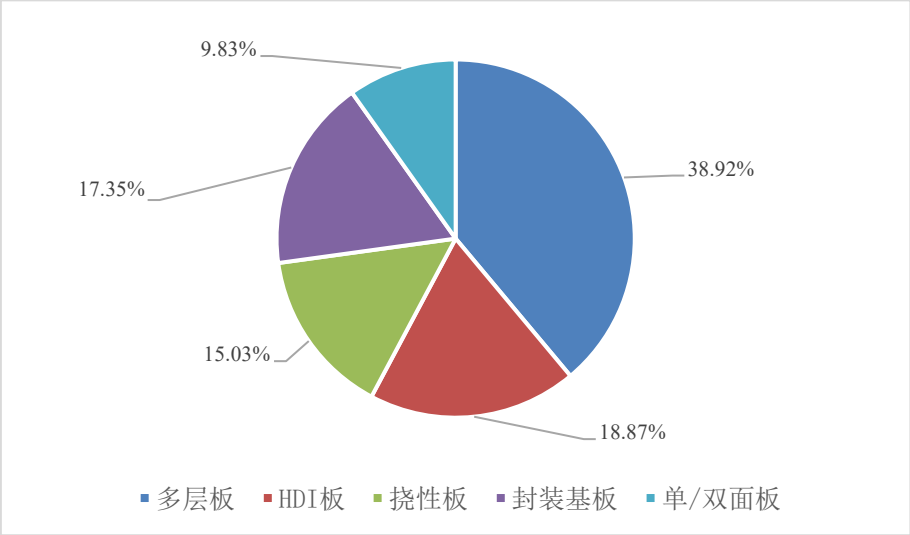
地区	2025 年产值	增长率	2030 年产值（预估）	复合增长率（预估）
中国大陆	496.52	20.90%	817.64	10.50%
中国台湾	99.02	14.10%	180.17	12.70%
亚洲	142.13	11.81%	267.45	13.48%
日本	64.99	11.30%	105.07	10.10%
美洲	37.96	7.50%	50.81	6.00%
欧洲	17.74	8.30%	24.96	7.10%
合计	**858.36**	**16.68%**	**1,446.11**	**11.00%**

数据来源：Prismark，本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家或地区。

3）全球 PCB 产品结构

根据 Prismark 统计，2025 年全球 PCB 细分产品的市场结构如下：

2025 年全球 PCB 细分产品结构



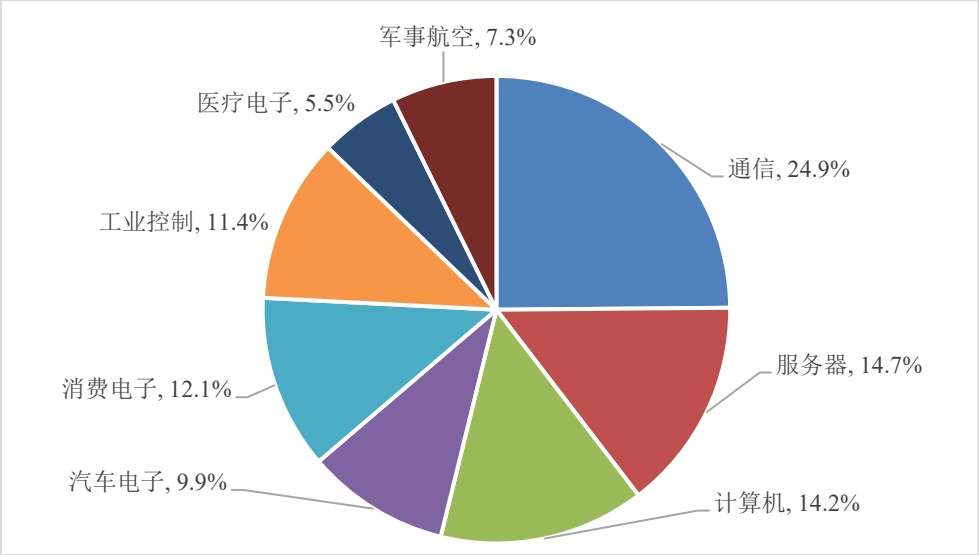
数据来源：Prismark

在全球 PCB 细分产品结构中，刚性板市场规模最大，其中多层板占比 38.92%，单/双面板占比 9.83%，HDI 板占比 18.87%；其次是封装基板，占比约

17.35%；挠性板占比约 15.03%。随着电子电路技术的快速发展，元器件集成度不断提高，电子产品对 PCB 高密度化的需求更加突出。未来在高速网络、人工智能、服务器/数据储存、汽车电子、卫星通讯等下游行业需求增长驱动下，高多层板、HDI 板的市场需求将以领先于行业整体增速而持续增长。

4）全球 PCB 下游应用领域

2025 年全球 PCB 下游应用领域情况



数据来源：Prismark

PCB 行业与下游电子信息产业的发展紧密相关。根据 Prismark 数据，2025 年 PCB 主要应用领域中，通信、服务器以及计算机占据较高比重，分别为 24.9%、14.7%以及 14.2%。

（2）中国大陆 PCB 市场概况

1）中国大陆 PCB 市场规模

根据 Prismark 数据，2025 年中国大陆 PCB 产业产值为 496.52 亿美元，占全球市场的 57.85%。2025 年至 2030 年，中国大陆 PCB 市场年均复合增长率将达 10.50%，产业前景广阔。

2014-2030 年中国大陆 PCB 产值及增长率（亿美元）

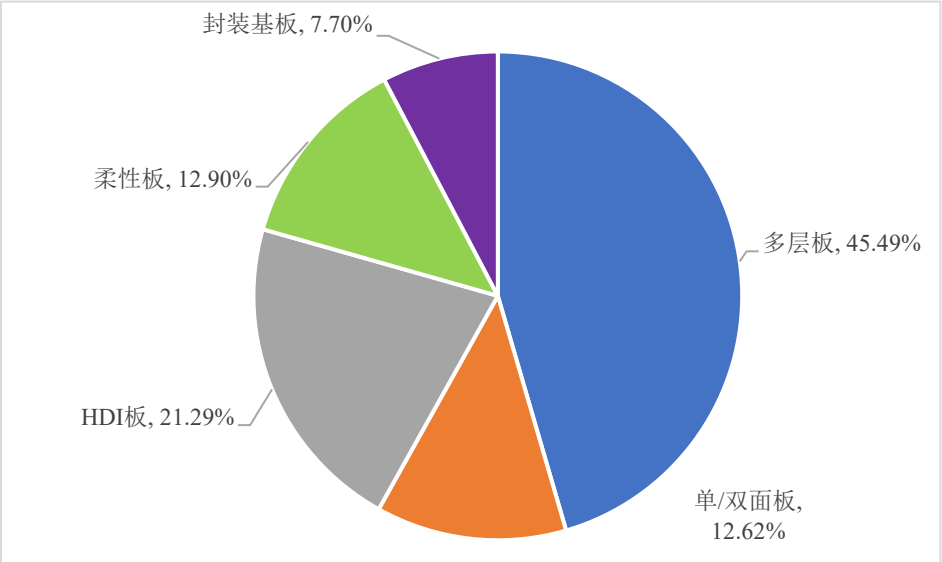


数据来源：Prismark

2）中国大陆 PCB 产品结构

根据 Prismark 统计，2025 年中国大陆刚性板依旧是市场主体，其中多层板占比达 45.49%，单/双面板及其他占比为 12.62%；其次为 HDI 板，占 21.29%；FPC 与封装基板的占比分别为 12.90%和 7.70%。从中长期趋势看，人工智能、高速通信及汽车电子等领域的强劲需求将持续推动高端 HDI、多层板以及封装基板等细分领域的发展。根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年中国大陆 18 层及以上高多层板、HDI 板与 FPC 板的年均复合增长率分别可达 21.6%、9.1%、3.9%。

2025 年中国大陆 PCB 细分产品结构



数据来源：Prismark

4、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）国家产业政策的实施，为 PCB 行业健康发展提供了政策保障

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板作为该产业的基础产品，国家相继出台了一系列扶持与鼓励政策，将 PCB 相关产品列为重点发展方向，推进产业升级与结构调整。2023 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路柔性电路板等列为鼓励类产业。2025 年 11 月工信部发布的《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》，从产业布局、生产规模、工艺技术、智能制造、绿色制造等多个维度对 PCB 行业提出明确要求，严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目，鼓励产业聚集发展，推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。2026 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，提出要壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推进国家人工智能创新高地建设，培育

智能原生新模式新业态，建设国家人工智能应用中试基地。上述各领域的技术进步与应用革新，均需以印制电路板为承载基础，相关技术迭代将持续为 PCB 行业创造新的增长空间。国家产业政策的落地实施，为 PCB 行业的稳健发展提供了有力的政策保障。

2）中国电子行业拥有完备的产业链条，上下游配套能力突出

中国电子信息产业保持快速发展态势，有效带动了产业链上下游的协同增长。目前，我国电子行业规模庞大、配套体系完善，产业集聚效应日益凸显。作为 PCB 产业的上游，覆铜板、半固化片、铜箔等主要原材料厂商供应能力强劲，能够快速响应 PCB 企业的采购需求。PCB 行业作为电子信息产业的基础环节，在产业链中发挥着承上启下的关键作用。完善的产业链布局使 PCB 企业既能高效获取原材料，又能及时响应下游客户需求，有力保障了产业的稳定运行。2020 年以来，面对全球宏观经济波动及国际贸易摩擦等外部挑战，受益于国内产业链的相对完整，中国 PCB 产业整体仍实现了稳健发展。

3）下游市场的蓬勃发展，为 PCB 行业的市场需求提供了强劲支撑

印制电路板的下游行业广泛，包括工业控制、通讯设备、计算机、消费电子、汽车电子、军事航空、医疗器械等。广泛的应用分布为印制电路板行业提供巨大的市场空间，降低了行业发展的风险。下游领域对 PCB 产品的高系统集成、高性能化的要求推动了 PCB 产品不断朝着“轻、薄、短、小”的方向迭代升级；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游领域产品的推陈出新提供了新的可能性。随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术、新应用不断涌现，5G、6G 网络建设的大规模推进及商用，新能源汽车渗透率不断提高，汽车电子化程度、自动驾驶技术和车联网不断发展，PCB 产业将迎来新一轮的快速发展。PCB 应用行业的技术革新以及新兴产业的发展为 PCB 行业带来新机遇，为 PCB 市场发展提供了强劲支撑。

（2）不利因素

1）技术水平存在一定差距

目前，中国的 PCB 行业产值已经稳居全球第一位，但与欧美、日韩等 PCB 强国相比，中国承接的高端产值比例依然低于外资企业。中国企业在生产技术、产品研发方面起步较晚导致 PCB 行业基础技术研究与技术沉淀相对薄弱，这些因素在一定程度上制约了 PCB 制造企业的发展。

2）市场竞争程度加剧

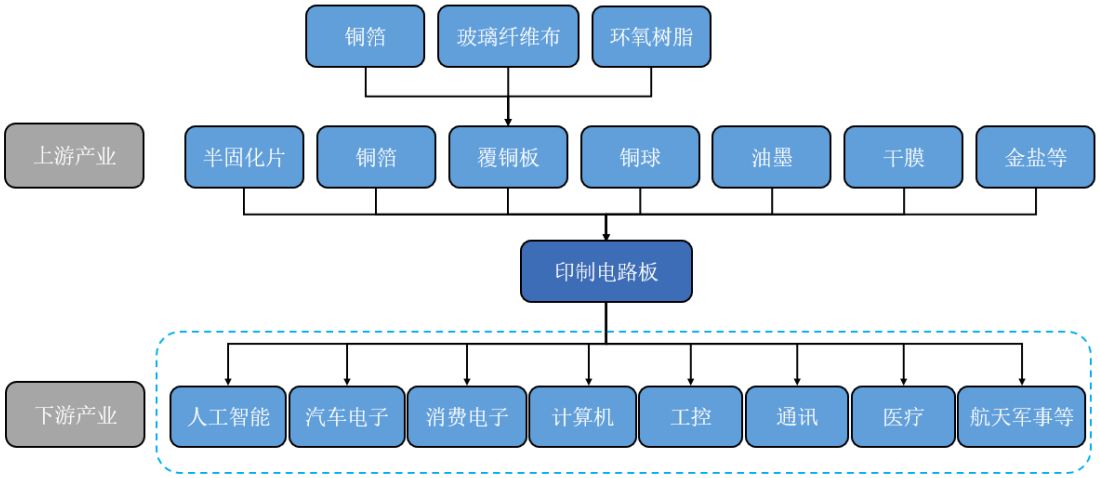
PCB 行业作为电子元器件的基础行业，在全球主要经济体经济增长率放缓的背景下，PCB 行业产值整体增长规模有限，这也使得 PCB 生产企业竞争更加激烈。同时，随着国内外 PCB 厂商陆续布局产能扩张项目，市场竞争日趋激烈，行业集中度日益提升，部分落后的中小企业将逐步退出市场，产能优势将集中到龙头企业。

3）安全生产、环境保护等监管要求不断提高

当前政府主管部门对企业安全生产和环境保护的要求不断提升，相关法律法规的标准保持从严趋势，执法力度不断加大，舆论监督的关注度也在不断提高，一方面带动了企业安全生产和环境保护水平的提高，有利于经济的可持续发展，另一方面也增加了企业的前期投入和生产成本，使企业面临更大的竞争压力。

5、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游发展状况

公司所处 PCB 行业上下游产业链情况如下：



（1）上游行业与 PCB 行业的关联性及发展状况

PCB 生产所需原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、金盐等，上游配套成熟，供应充足、竞争充分，配套服务满足行业发展需求。覆铜板作为核心材料，承担导电、绝缘、支撑功能，其性能直接影响 PCB 产品性能，占生产成本 20%-40%，价格波动对成本影响显著。铜球、铜箔等铜基材料亦为重要原材料，铜价变化对成本有较大影响。

1）覆铜板

覆铜板作为 PCB 制造的核心材料，是将玻璃纤维布或其他补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔经热压而成，再经过蚀刻、电镀、多层板压合等工序处理后制成印制电路板。中国覆铜板产值在全球占据主导地位，占全球产品 70%以上。

2）铜球及铜箔

铜箔的作用是在由覆铜板做成的印制电路板上形成导电线路，其电路的形成是在覆铜板上有选择地经过蚀刻等工艺制成。而铜球作为阳极材料在 PCB 电镀中，通过电解作用持续供给铜离子，于孔壁和线路上形成均匀、致密且导电性良好的铜镀层。铜球、铜箔一般按照“铜价+加工费”方式进行定价。

（2）下游行业与 PCB 行业的关联性及发展状况

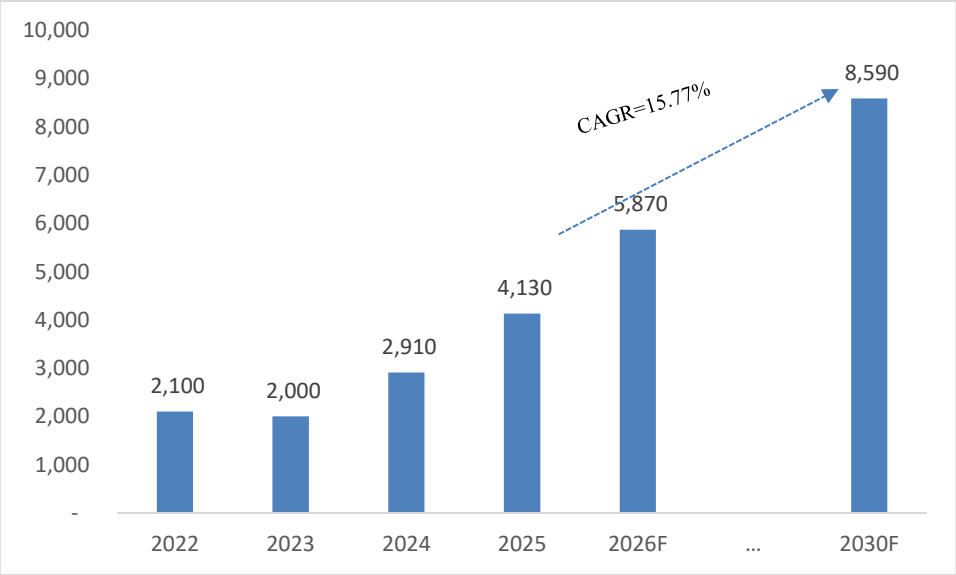
PCB 下游应用领域主要包括人工智能、通信电子、汽车电子、消费电子、工控安防等，各应用领域的发展现状及未来发展趋势情况如下：

1）人工智能领域

人工智能领域 PCB 应用主要集中于 AI 服务器、高性能计算（HPC）及数据中心基础设施，涵盖 AI 加速服务器、存储阵列、通用服务器、高速互连模块、电源模组等产品。此类设备对 PCB 提出高多层、低损耗、高速传输及高效散热等严苛要求：海量数据训练与推理推高算力密度和功耗，带动多层板、HDI 及高速封装基板需求，同时服务器电源需实现高效率、低损耗与高功率密度，以

保障 AI 集群稳定运行。Prismark 预测，2026 年全球服务器/数据存储市场规模将达 5,870 亿美元，同比增长 42.13%；数据中心/服务器相关 PCB 市场占比预计从 2025 年的 14.73%提升至 2030 年的 22.41%，对应复合年增长率约 15.77%，为增长最快的应用板块之一。

2022-2030 年服务器/数据存储 PCB 市场（百万美元）

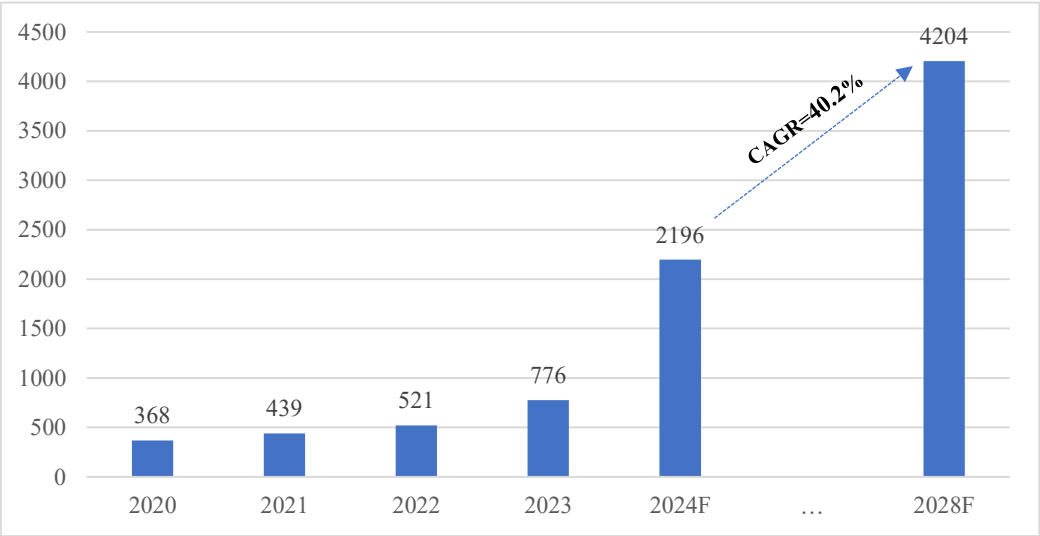


数据来源：Prismark

①AI 服务器/数据存储

AI/HPC 服务器 PCB 市场在 2022–2023 年实现了 48.9%的爆发式增长，并在 2023–2028 年间保持 40.2%的年均复合增长率，带来远超常规服务器的巨大增量需求，成为推动整个 PCB 行业结构升级的核心驱动力。

2020-2028 年 AI 服务器/数据存储 PCB 市场（百万美元）



数据来源：Prismark

②服务器电源

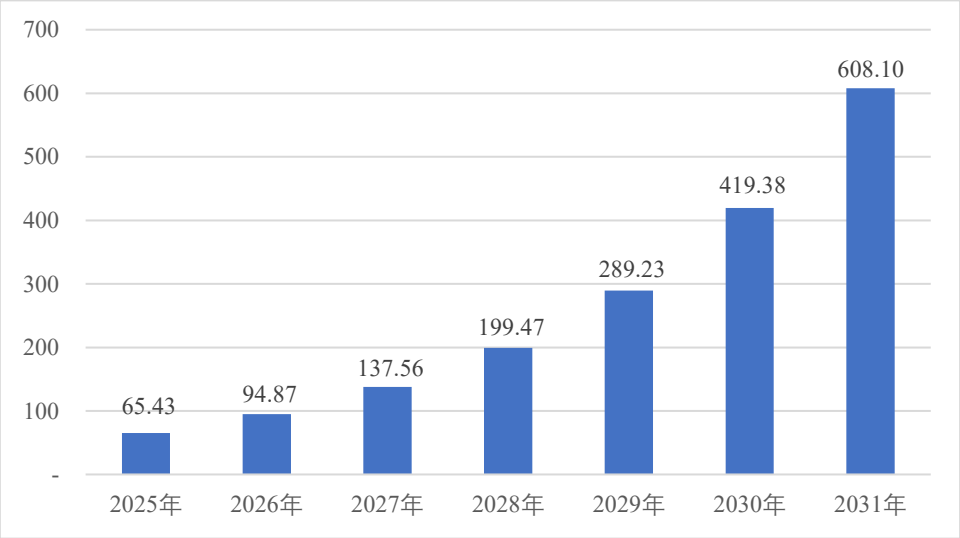
服务器电源模块是服务器系统的核心供电单元，实现交流电向服务器直流电的转换，为整机提供稳定高效能源供给。对比传统线性电源，服务器电源具备高效率、小型化、低热损耗、高稳定性、宽电压适应性等特点。AI 服务器普遍采用分级供电架构，配套电源 PCB 按供电链路可划分为一次、二次、三次三个层级：一次电源板将外部交流电 AC 或高压 DC 转换为服务器内部直流母线电压，属于一级能量转换环节，产品功率等级高，对散热设计与绝缘耐压要求较高；二次电源板将一次电源输出的直流母线电压转换为中间电压，属于二级能量分配环节，侧重保障电压输出稳定性与功率传输效率；三次电源板将中间电压进一步降压至芯片级工作电压，直接为 GPU、CPU、ASIC 等核心芯片供电，属于末端精准调压环节，强调高频动态响应能力与小型化集成设计。公司本次募投项目产品全面覆盖上述三类电源 PCB，可完整匹配 AI 服务器高功率、高可靠性的供电配套需求。

产品分类	核心功能	核心任务	具体定义与技术特征
一次电源板	主电源转换层	高压输入转换及一级降压	将外部交流电 AC 或高压直流电 DC 转换为服务器内部直流母线电压，属于一级能量转换环节，产品功率等级高，对散热设计与绝缘耐压要求极高。

产品分类	核心功能	核心任务	具体定义与技术特征
二次电源板	母线电源分配层（DC-DC）	中间母线电压转换与分配	将一次电源输出的直流母线电压转换为中间电压，属于二级能量分配环节，侧重保障电压输出稳定性与功率传输效率。
三次电源板	负载点供电互联 PCB（PoL）	芯片级精密供电	将中间电压进一步降压至芯片级工作电压，直接为 GPU、CPU、ASIC 等核心芯片供电，属于末端精准调压环节，强调高频动态响应能力与小型化集成设计。

受益于 AI 算力需求爆发式增长，AI 服务器电源作为电源组件市场的核心增量赛道，展现出强劲成长趋势。根据 Valuates Reports 的数据，在人工智能技术发展的刺激下，2025 年全球 AI 服务器电源市场规模为 65.43 亿美元，预计到 2031 年将增长至 608.10 亿美元，2025-2031 年复合增长率达到 45.00%。

全球 AI 服务器电源市场规模（单位：亿美元）



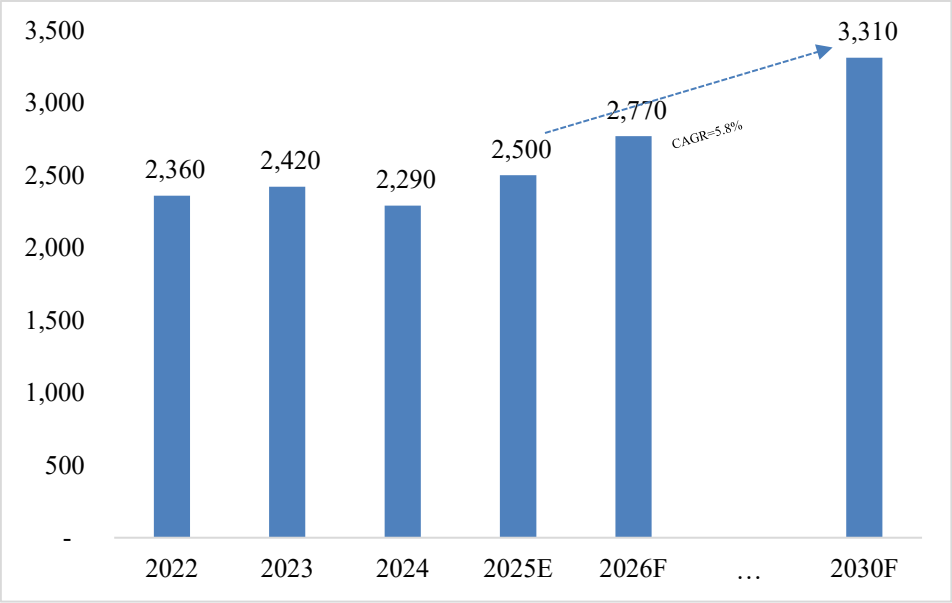
数据来源：Valuates Reports

2）通信领域

通信设备是支撑有线与无线网络传输的核心基础设施，主要包含通信基站、路由器、交换机、基站天线、射频器件及骨干网传输设备等类别。随着 5G/6G 技术加速普及，通信设备对 PCB 的高频特性、高速工艺及配套材料提出更高标准；在通信电源领域，低功耗与高功率密度的性能需求进一步凸显；同时，全球数据流量持续攀升推动高速芯片与高多层板协同应用深化，尤其对保障信号

高速传输的高频高速板产品需求显著增长。根据 Prismark 预测，2030 年全球无线与有线通信设备市场规模有望达到 3,310 亿美元，2025-2030 年期间年均复合增长率约为 5.8%，行业增长趋势下，通信领域 PCB 需求将同步受益于市场扩容与技术升级。

2022-2030 年全球有线及无线通信设备市场规模及预测（亿美元）

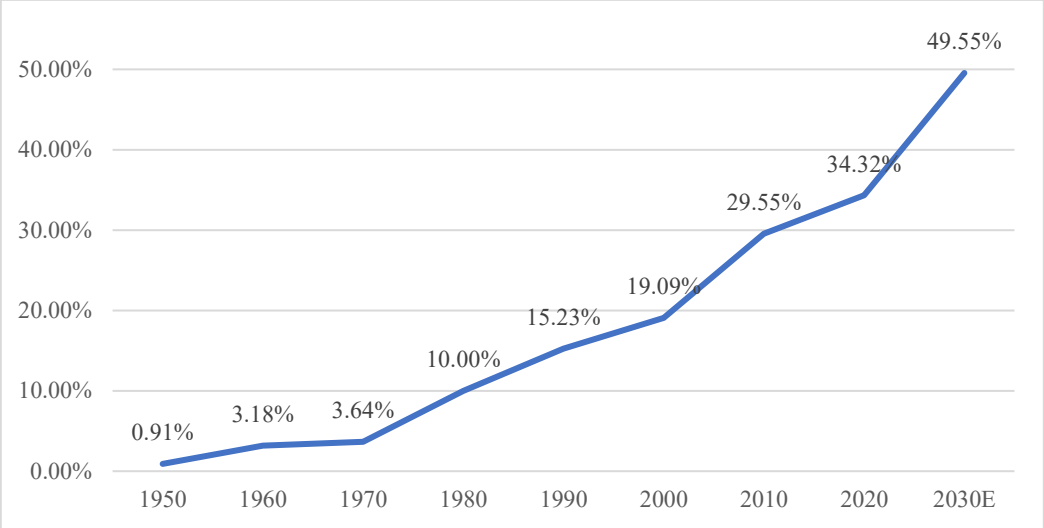


数据来源：Prismark

3）汽车电子领域

电动化、智能化、网联化已成为全球汽车产业核心发展趋势，新能源汽车产业链覆盖电机、电池、电控系统及充电配套设施等关键环节，而 PCB 作为车载电子与电气设备的核心基础部件，是产业链功能实现的重要支撑。当前，人工智能、5G、车联网及新型感知技术加速迭代，叠加消费者对车载信息娱乐、安全功能的需求持续升级，推动汽车电子系统智能化与电子化水平显著提升，进而带动汽车电子占整车制造成本比重不断攀升。据中国产业信息网数据，汽车电子成本占比自 1950 年的 0.91%稳步增长，至 2020 年已达 34.32%，预计 2030 年有望升至 49.55%。汽车电子成本占比的提升直接拉动汽车用 PCB 需求扩容，同时汽车功能的持续升级也驱动 PCB 产品向更高性能、更复杂工艺方向迭代优化。

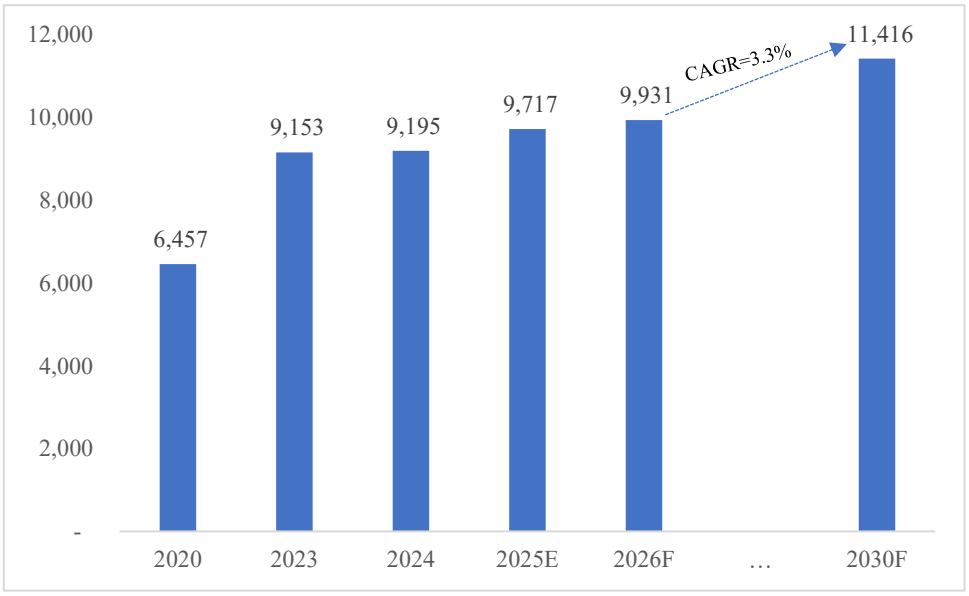
1950-2030 年汽车电子占整车制造成本比重及预测



数据来源：中国产业信息网

汽车电子持续增长的需求带动车用 PCB 市场快速增长，根据 Prismark 数据，2025 年至 2030 年全球汽车电子 PCB 产值年均复合增长率为 3.3%，2030 年预计产值达 114.16 亿美元。

2020-2030 全球汽车电子 PCB 产值（百万美元）

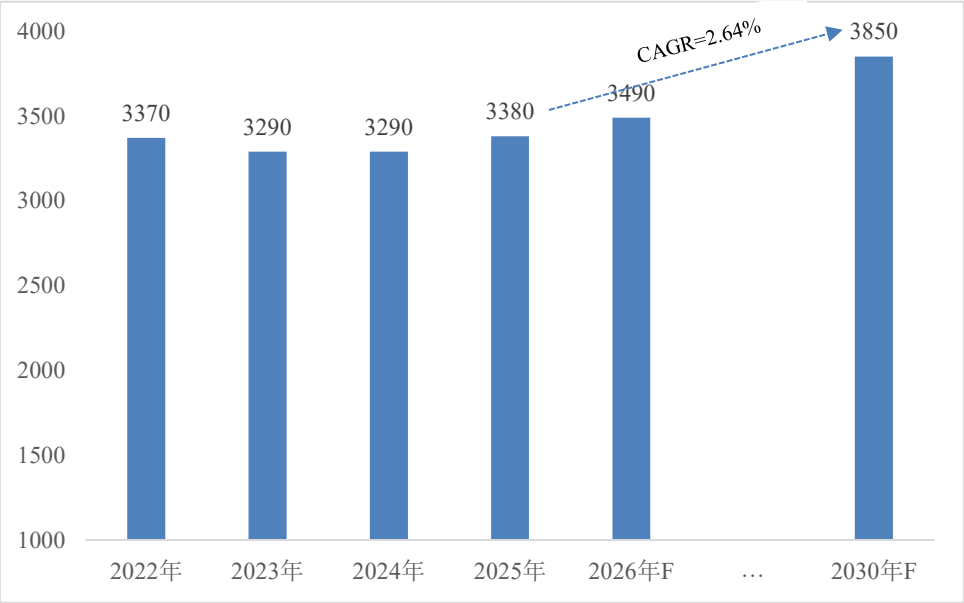


数据来源：Prismark

4）消费电子领域

消费电子作为电子信息制造业的核心组成部分，与居民日常生活需求紧密相连，涵盖手机、电脑、家电、可穿戴设备等诸多细分领域。该品类所用 PCB 通常具备大批量、轻薄化与小型化特征。消费电子行业下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类持续涌现，每一轮新消费热点的兴起均驱动产品升级换代，进而带动印制电路板需求增长。当前，行业正步入以人工智能、物联网和智能家居为代表的新增长阶段，预计先进技术将持续深化对消费场景的渗透，为 PCB 市场注入新动力。根据 Prismark 统计预测，2030 年全球消费电子产值将达到 3,850 亿美元，2025 年至 2030 年期间复合增长率为 2.64%。

2022-2030 年全球消费电子市场规模及增长预测情况（亿美元）

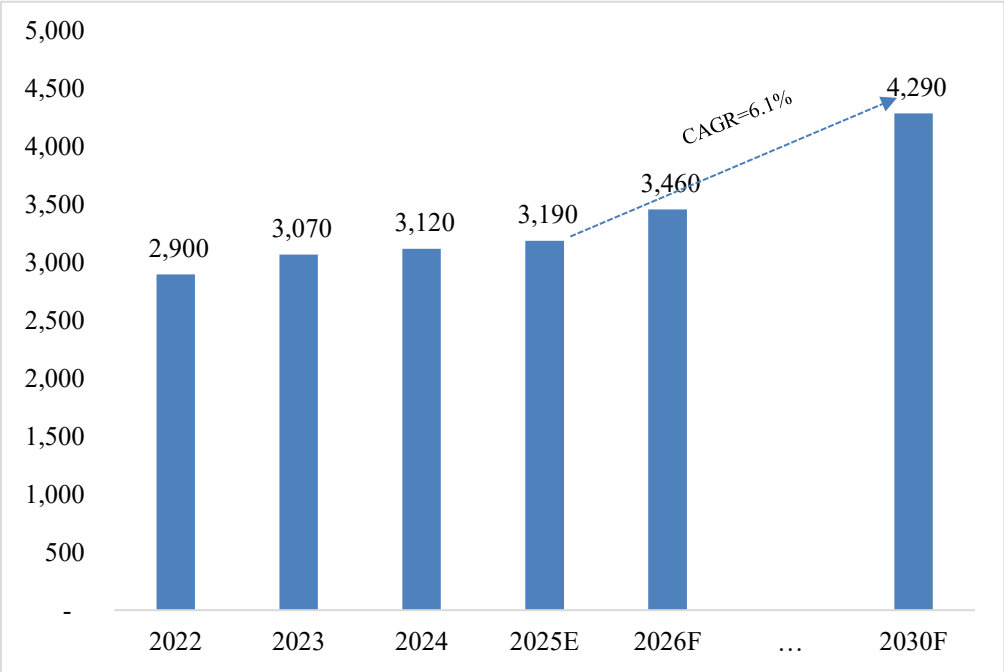


数据来源：Prismark

5）工业控制

工业控制指利用电子电气、机械技术与软件系统，实现生产制造过程的自动化、精准化、高效化，并提升流程可控性与可视性。当前，在全球各国政策对工业自动化持续推动、物联网与人工智能技术加速渗透，以及制造业对效率与生产力不断提升需求等因素共同作用下，工控与工厂自动化市场迎来显著增长。随着制造业自动化水平不断提高，工控市场规模持续扩张，为上游 PCB 行业带来稳定且持续的需求支撑。根据 Prismark 预测，预计 2030 年全球工业控制市场规模将达到 4,290 亿美元，2025 至 2030 年年均复合增长为 6.1%。

2022-2030 年全球工业控制市场规模（亿美元）



数据来源：Prismark

（三）行业发展趋势

AI 工业革命加速算力、高速网络通信、新能源汽车等下游领域发展，为 PCB 行业打开成长空间。未来，在人工智能浪潮持续引领下，汽车电子、服务器/数据存储等下游需求将稳步增长，带动高多层板、HDI 板维持较高增速。同时，传统应用的迭代升级也为 PCB 产业注入新的增长动能。展望未来，随着电子产品向微型化、轻量化、多功能化演进，PCB 产品将加速向高密度、高性能、绿色环保方向升级，行业技术含量有望持续提升。

1、高密度化

高密度化对电路板的孔径、布线宽度、层数及叠孔结构提出更高要求，高阶 HDI 技术是 PCB 技术的重要体现。与传统多层板相比，HDI 板通过盲孔与埋孔技术减少通孔数量，提升元器件密度，实现更高集成度。高阶 HDI 技术在 AI 高速 PCB 中尤为关键，其材料、设计及工艺的协同优化对信号完整性与可靠性提出更高要求。随着 AI 算力需求的提升，高阶 HDI 技术正向超高多层、超低损耗方向发展。

2、高性能化

高性能化主要是指 PCB 在散热性、阻抗控制、信号完整性等方面持续提升，从而增强产品功能与可靠性。现代电子产品信息传输量不断加大，信号向高频化方向发展，PCB 需具备良好的信号完整性，才能保障信息有效传输和最终产品性能稳定。与此同时，以 AI 服务器电源为代表的电力电子产品功率密度不断提高，单位面积内功率和发热量明显增加，对 PCB 的载流能力、散热性能和耐温可靠性提出更高要求。在高功率密度条件下，热量更为集中，AI 服务器电源等应用对散热和长期稳定运行的要求尤为突出，具备良好散热性能的 PCB 才能保证产品在适宜温度下工作。在此趋势下，金属基板、厚铜板、高阶 HDI 板及内埋器件板等产品在高功率密度场景下形成了较好的散热与载流性能，推动 PCB 产品向高性能化方向发展。

3、环保发展

PCB 行业生产工艺复杂，其中部分工艺会对环境产生污染，污染物处理过程比较复杂。随着各国环保要求的提高，PCB 行业制定了一系列的环保规范，考虑到可持续发展的需要，使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品成为 PCB 行业的发展趋势。

（四）行业竞争环境与竞争优势

1、全球 PCB 行业竞争格局

全球 PCB 生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入情况如下：

2025 年全球前十大 PCB 企业

单位：亿美元

序号	公司名称	国家/地区	营业收入	基本情况
1	ZD Tech（臻鼎）	中国台湾	58.69	中国台资控股厂商，主营柔性板、HDI 板、刚性板及封装基板
2	Unimicron（欣兴电子）	中国台湾	42.25	中国台资控股厂商，主营封装基板、HDI 板、多层

				板等
3	Dongshan Precision（东山精密）	中国大陆	36.05	内资厂商，主营柔性板、刚性板
4	Shennan Circuit（深南电路）	中国大陆	32.95	内资厂商，主营印制电路板、电子装联、封装基板
5	TTM Technologies（迅达）	美国	29.06	北美最大的电路板厂商，主营刚性板、HDI 板、柔性板等
6	WUS Group（沪电股份）	中国大陆	27.60	中国台资控股厂商，主营多层刚性板，HDI 板等
7	Victory Giant（胜宏科技）	中国大陆	26.86	内资厂商，主营高端多层板、HDI 板、柔性电路板及软硬结合板
8	Compeq（华通）	中国台湾	24.46	中国台资控股厂商，主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚挠结合板等
9	Tripod（健鼎）	中国台湾	23.61	中国台资控股厂商，主营多层刚性板等
10	Kinwong（景旺电子）	中国大陆	22.73	内资厂商，主营多层刚性板、柔性板等

2、中国 PCB 市场竞争格局

目前我国 PCB 行业已形成充分竞争、百花齐放的格局。根据 CPCA 公布的中国电子电路行业排行榜，2025 年中国主要 PCB 厂商排名情况如下：

2025 年中国 PCB 企业排名

单位：亿元

序号	公司名称	2025 年营业收入	基本情况
1	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	391.47	臻鼎的控股子公司，其生产基地分布在深圳、淮安、秦皇岛、营口、印度清奈、泰国巴真等地
2	苏州东山精密制造股份有限公司	256.20 注	内资厂商，A 股上市公司，其大陆生产基地分布在苏州、盐城和珠海等地
3	深南电路股份有限公司	236.47	内资厂商，A 股上市公司，生产基地分布在深圳、无锡、南通、泰国等地
4	胜宏科技（惠州）股份有限公司	192.92	内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性电路板、柔性电路板、HDI 板等，生产基地分布在惠州、长沙、益阳、泰国、越南、马来西亚等地

5	沪士电子股份有限公司	189.45	中国台资控股厂商，A 股上市公司，主营单双面板、多层及 HDI 板，生产基地分布在昆山、黄石、常州和泰国等地
6	健鼎科技股份有限公司	153.52	中国台资控股厂商，主营多层刚性板等，生产基地分布在无锡、仙桃、中国台湾等地
7	深圳市景旺电子股份有限公司	153.08	内资厂商，A 股上市公司，主营产品为刚性板、柔性板、金属基板，生产基地分布在深圳、龙川、江西、珠海、泰国等地
8	华通电脑股份有限公司	125.63	中国台资控股厂商，主营多层刚性板、HDI 板、软板与刚挠结合板等，生产基地分布在重庆、苏州、惠州、中国台湾、美国等地
9	欣兴电子股份有限公司	124.06	中国台资控股厂商，主营封装基板、HDI 板、多层板等，生产基地分布在深圳、苏州、昆山、黄石、中国台湾、泰国等地
10	建滔集团有限公司	122.00	中国港资控股厂商，主营单双面板、多层板及 HDI 板

注：数据源自 CPCA、上市公司年报；上表东山精密的营业收入为其 PCB 业务收入。

3、公司市场地位

公司深耕 PCB 制造领域多年，聚焦电力电子细分赛道，已建立覆盖全工序的生产体系与完善的服务配套，产品覆盖面广、技术储备丰富，在电力电子 PCB 领域具备较强的综合竞争力。依托持续的市场开拓和客户资源积累，公司市场份额稳步扩大，行业影响力不断增强。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的行业排行榜，公司连续多年入选“中国电子电路行业排行榜百强企业”，2025 年位居综合 PCB 企业第 44 位。

4、主要竞争对手

PCB 生产企业较多，企业生产经营情况受到产能规模、产品类型、下游应用领域等影响差别较大。公司产品主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业控制等领域。公司主要竞争对手有胜宏科技（300476.SZ）、科翔股份（300903.SZ）、奥士康（002913.SZ）、景旺电子（603228.SH）、依顿电子（603328.SH）、骏亚科技（603386.SH）、世运电路（603920.SH）、博敏电子（603936.SH）、威尔高（301251.SZ）、沪电股份（002463.SZ）、深南电路

（002916.SZ）、生益电子（688183.SH）、东山精密（002384.SZ）、满坤科技（301132.SZ）等同行业公司，基本情况如下：

证券简称	地区	上市日期	产品特征及应用领域
景旺电子	广东深圳	2017/1/6	大批量刚性板、柔性板和金属基板，主要应用于通信、汽车领域
胜宏科技	广东惠州	2015/6/11	大批量刚性电路板为主，主要应用于计算机、通信等领域
世运电路	广东鹤山	2017/4/26	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、通讯领域
奥士康	湖南益阳	2017/12/1	大批量刚性及柔性电路板、金属基板，主要应用于汽车、消费电子等领域
依顿电子	广东中山	2014/7/1	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、通讯、计算机、医疗工控等领域
科翔股份	广东惠州	2020/11/5	大批量刚性电路板为主，主要应用于汽车、消费电子、工控及通信领域
博敏电子	广东梅州	2015/12/9	大批量刚性电路板为主，主要应用于数据、通讯、汽车电子、工控安防等领域
骏亚科技	广东惠州	2017/9/12	大批量刚性线路板为主，主要应用于消费电子、工控及医疗等领域
东山精密	江苏苏州	2010/4/9	大批量柔性板、刚性板，主要应用于消费电子、通信、计算机、汽车、工控设备等领域
深南电路	广东深圳	2017/12/13	大批量刚性板、封装基板及电子装联产品，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、消费电子、汽车电子等领域
沪电股份	江苏昆山	2010/8/18	大批量刚性电路板为主，主要应用于通信、数据中心、汽车等领域
满坤科技	江西吉安	2022/8/10	大批量刚性线路板为主，主要应用于通信、消费电子、工控、安防、汽车电子等领域
生益电子	广东东莞	2021/2/25	大批量刚性电路板为主，主要应用于通信、计算机及网络、消费电子、 工控医疗等领域
威尔高	江西吉安	2023/9/6	多层印制电路板、双面印制电路板，主要应用于 AI 服务器电源、显示和汽车电子等领域

注：上述信息来源于同行业公司的招股说明书、定期报告、行业研究报告等资料。

5、所处行业的主要壁垒

PCB 行业是典型的技术密集型、资金密集型行业，市场潜在进入者面临技术、客户、环保、资金、管理能力等多方面的行业壁垒。

（1）技术壁垒

印制电路板产品类型丰富，涵盖单面、双面、多层、HDI、柔性、刚挠结合及封装基板等多个品类，且需针对不同下游应用在层数、材料、厚度公差、散热及可靠性等方面进行高度定制。其制造流程复杂，涉及电子、机械、计算机、光学、材料与化工等多学科技术，对工艺水平要求极高。随着人工智能、高性能计算、汽车电子、5G/6G 通信及可穿戴设备等新兴领域快速发展，行业正加速向高密度、高精度、轻薄化演进。企业唯有持续投入研发、不断提升工艺能力，方能及时响应客户不断升级的技术需求，行业因此形成显著的技术壁垒。

（2）客户壁垒

印制电路板是电子产品的关键元器件，其质量稳定性、交期及环保合规性直接决定终端可靠性。下游客户在遴选供应商时，普遍设置严格准入门槛，综合评估企业规模、自动化水平、环保资质、财务状况等，认证周期通常为数月至一年以上，并须经过小批量到量产的逐级验证，尤其是在汽车电子、AI 服务器电源等领域，产品认证周期更长。后续双方的合作关系一旦确立，客户黏性较高，轻易不会更换供应商，由此对新进入者形成显著的客户认证壁垒。

（3）环保壁垒

印制电路板制造在电镀、蚀刻、印刷等环节产生废水、废气及固废。近年来，生态环境部门通过在线监测、现场执法等手段强化监管，对排放不达标企业实施关停或限期整改。我国相继出台了《电子信息产品污染控制管理办法》《清洁生产标准—印制电路板制造业》《中华人民共和国环境保护税法》《印制电路板行业规范条件》《排污许可证申请与核发技术规范—电子工业》《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录（2026 年版）》等法规，对有害物质、清洁生产、排放许可提出更高要求。环保标准持续提升，要求企业同时具备成熟的环保处理技术、经验及稳定达标能力，并持续投入升级环保设施与运营系统，形成对新进入者的显著壁垒。

（4）资金壁垒

PCB 行业资金壁垒较高，企业需在投产前期一次性投入大量资金，购置多品类生产设备及高端检测系统，以保障产品一致性与可靠性；后续仍需持续追加资本，用于生产线升级、工艺改进及研发投入，方能维持技术领先与产品竞争力。因此，PCB 制造呈现明显的资金密集型特征，对潜在进入者构成较高门槛。

（5）管理能力壁垒

PCB 产品品类多、批次杂、定制化程度高，生产流程长、工序繁多。企业需具备覆盖研发、采购、生产、品质管控、交付、环保合规等多环节的精细化管理能力才能生产出符合客户要求的产品。由于下游电子产品精密性和生产模式的特点，印制电路板品质不稳定或交货不及时均会较大程度影响客户对产品的信心，因此成本控制、产品品质的稳定性、准时交货能力是 PCB 企业核心竞争力的体现。构建高效运转、柔性化的生产经营管理体系需要长期经验积累。该要求对新进入者构成了较高的进入障碍。

6、发行人的竞争优势和劣势

（1）发行人的竞争优势

1）技术研发优势

公司是高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）会员单位。公司始终紧跟下游电子信息产品的发展趋势，专注于细分领域的技术研发，形成并拥有多项自主研发的核心技术，涉及高多层板、厚铜板、5G 天线板、高频高速板、软硬结合板、内埋器件板等产品及其先进材料、先进制造工艺、电学参数设计和控制及质量管控技术。截至目前，公司及其子公司已获得国家级绿色工厂、广东省工程技术研究中心、深圳市专精特新中小企业等荣誉。

报告期内，公司研发投入占当期营业收入的比例分别为 4.32%、5.27%、5.57%和 5.17%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已取得国内专利 134 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 120 项。

2）客户资源优势

公司实行多行业布局的市场战略，在通信及数据中心、工业控制、汽车电子、消费电子等领域具备丰富的行业经验，积累了一批行业地位领先、市场影响力强、资质信誉和社会形象优秀的知名客户。公司与多家全球领先的通信及数据中心设备服务商、FlexPower、MPS、台达、瑞萨、TI、ADI、muRata、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Jabil、比亚迪、瑞声、歌尔、立讯等众多优质客户保持长期稳定的合作关系。

同时，公司高度重视下游领域涌现的新机遇并积极布局 AI 服务器电源领域，持续迭代升级生产工艺、产品品质管控体系、订单交付保障能力及综合客户服务体系，通过深度嵌入客户前端研发环节，积极开展技术对接、产品试样、小批量试产及联合研发等深度协同工作，持续提升自身技术研发与工艺创新实力，有效提升市场认可度与潜在客户合作粘性。公司亦稳步落地国际化发展战略，海外泰国生产基地现已实现批量量产，并顺利通过多家海外客户的资质体系审核，有效完善了公司全球化产能布局，为公司持续拓展海外市场、扩大境外业务规模、提升全球市场竞争力奠定了坚实基础。

3）生产管理优势

PCB 下游用户通常要求 PCB 具备高可靠性、使用寿命长和可追溯性强等特点，对 PCB 生产商的工艺和材料等要求较高。公司建立了完善的质量控制体系，确保为客户提供高品质的 PCB 产品。印制电路板生产涉及内层、压合、钻孔、电镀、干膜、绿油、文字、表面处理、外形、电测、终检、包装等十几道工序，具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点，且下游市场对 PCB 产品的精密度、可靠度、先进性等要求日益提高，对 PCB 制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。PCB 产品高度定制化的特征客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。

公司持续推进数字化生产管理体系建设，依托数字化技术实现生产流程、设备参数、检测数据等全流程一码溯源管控，并已取得 ISO9001、IATF16949、ISO13485、ISO14001、QC080000、ISO27001、ISO50001、RBA、CQC、UL 等多项质量、安全、环境及合规类权威体系认证，在销售、采购、生产全链路搭

建了标准化、规范化的品质管控体系。通过长期技术积累与流程迭代，公司沉淀了成熟先进的生产工艺，建立了完善的业务标准与作业规范，实现生产经营各环节可控、可追溯、可管控，有效保障产品质量与可靠性，获得下游客户的广泛认可与高度信赖。

4）专业人才优势

公司秉持“以人为本”的发展理念，将人才梯队建设置于战略核心位置，构建了先进的人才管理平台与完善的员工培育体系，通过系统化培养与发展机制，打造出一支兼具高素质、高职业素养与强协作能力的经营管理团队及研发队伍。公司管理团队核心成员均拥有多年行业深耕经验，具备扎实的专业知识储备与敏锐的市场趋势洞察力，能够精准把握行业发展机遇、高效统筹企业运营，为公司业务快速拓展与经营效率提升提供坚实支撑。核心技术人员团队普遍具备深厚的专业背景与丰富的实践经验，是公司核心技术沉淀、产品创新研发的关键力量。近年来，核心技术团队在经营实践中成效突出，成功研发多项核心专利技术，持续推动公司产品向新应用领域延伸，有效保障了公司经营业绩的稳步增长，为企业长期发展奠定了坚实的技术与人才基础。

（2）发行人的竞争劣势

1）公司经营规模相对较小

相较于行业内较早上市的同行业企业，公司目前整体营业收入规模相对偏小。尽管近年来公司主营业务收入呈现逐年增长态势，经营业绩稳步提升，但与境内外印制电路板行业龙头企业相比，在营业收入体量及市场份额方面仍存在一定差距，未来公司需进一步扩大业务规模，持续提升市场占有率，以增强行业竞争力。

2）品牌知名度有待提升

国内印制电路板行业参与者众多，竞争充分。尽管公司已拥有沙井、松岗、鹤山、泰国等四个生产基地的产业布局，具备稳定制造能力，与若干知名客户建立了稳固长期合作关系，但相较行业领先企业，公司的品牌影响力仍待提升。

四、公司主营业务的基本情况

（一）公司产品或服务的主要内容

公司自成立以来始终专注于印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的研发、生产与销售，生产的产品包括单面板、双面板、多层板等，产品覆盖高频高速板、金属基板、刚挠结合板、高阶 HDI 板、内埋器件板等多种类型，主要应用于通信及数据中心、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等领域。

公司在 PCB 制造领域拥有丰富的行业经验和长期的技术积累，具备 PCB 全制程生产能力和全方位服务体系，经过多年市场开拓和客户积累，市场份额不断扩大，行业影响力不断增强。公司在细分市场领域拥有了较为稳定的客户资源，与多家全球领先的通信及数据中心设备服务商、FlexPower、MPS、台达、瑞萨、TI、ADI、muRata、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Jabil、比亚迪、瑞声、歌尔、立讯等众多优质客户保持长期稳定的合作关系。

作为国家高新技术企业、国家级绿色工厂、广东省通讯及新能源线路板工程技术研究中心、广东省线路板新材料工程技术研究中心、深圳市专精特新中小企业，公司在产品质量、交付效率、技术服务等方面得到客户广泛认可。公司连续多年荣获中国电子电路行业协会（CPCA）授予的中国电子电路行业排行榜百强企业称号。

自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要业务模式

1、采购模式

公司已建立完善的采购管理体系，通过严格筛选并持续评估合格供应商，保障所有采购的原材料符合生产质量要求。采购部门负责执行主要和辅助原材料的采购任务，严格管控采购过程，落实成本控制策略。

公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和金盐等。针对不同特性的原材料，公司采取以下两种方式进行采购：（1）对于常备物料如覆铜板、半固化片、氰化金钾、铜箔和铜球等常用通用的主辅材料，公司根据预计的日常消耗量定期进行采购，以确保库存充足；（2）对于非常备物料如特殊耗材等，公司根据实际的生产需求进行采购，确保能够满足特定的生产要求。

2、生产模式

公司建立了完善的生产管理体系及快速高效的客户订单处理流程，能够快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货。由于 PCB 为定制化产品，公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据下游客户具体订单需求开展设计与生产。

3、销售模式

公司采用以直销为主的销售模式，绝大部分销售订单或合同均与产业链下游客户直接签订，少数通过贸易类客户进行买断式销售。公司下游应用领域以通信及数据中心、工业控制、汽车电子、消费电子等为主，上述客户更看重产品品质、交期等服务能力。公司客户多具有严格的供应商准入标准，合作前期客户一般会选择少量产品交予公司打样试产，同时对公司产能、资质、质量、环保、安全、售后服务等能力进行全方位考察。考察通过并列入其供应商体系后，客户一般会与公司签订总体性的销售框架合同或分批次给予订单，约定技术参数、销售单价、数量、信用账期、交货周期等，公司据此安排生产及交货。

4、研发模式

公司坚持以自主研发为主导的研发模式，紧密围绕业务发展目标，深度契合市场发展方向，精准选择研发课题、科学配置项目人员、规范实施项目管理、全面评价研发成果，通过实施严谨的项目管理程序，确保研发项目的顺利推进与高效执行。近年来，公司紧盯 AI 及数据中心、新能源汽车、新一代通信技术、工业自动化等前沿领域，围绕“高多层、高密度、刚挠结合、高频高速、内埋器件、PSIP”等行业发展趋势，攻克高阶及任意层互联厚铜 HDI 板、PSIP 与内埋

工艺等前沿技术难题，从材料、设计、工艺技术多维度提前储备技术，重点研发新产品、新技术、新工艺，不断优化产品结构，提升产品快速响应和交付能力，以满足客户日益个性化的生产需求。

（三）营业收入情况

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	104,752.24	89.37	167,794.83	89.29	129,259.68	88.90	113,167.34	91.18
其他业务收入	12,455.36	10.63	20,118.15	10.71	16,138.80	11.10	10,945.42	8.82
合计	**117,207.60**	**100.00**	**187,912.99**	**100.00**	**145,398.48**	**100.00**	**124,112.76**	**100.00**

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入占营业收入比重均值为 89.69%，主营业务突出。

2、主营业务收入按产品类别划分情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分情况如下：

单位：万元、%

产品类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
单双面板	15,631.82	14.92	27,676.23	16.49	22,298.46	17.25	17,724.69	15.66
多层板	89,120.42	85.08	140,118.61	83.51	106,961.22	82.75	95,442.65	84.34
合计	**104,752.24**	**100.00**	**167,794.83**	**100.00**	**129,259.68**	**100.00**	**113,167.34**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入分别为 113,167.34 万元、129,259.68 万元、167,794.83 万元和 104,752.24 万元，整体呈稳步上涨趋势。

（四）主要产销量情况

报告期内，公司产能、产量、销量情况如下：

单位：万㎡

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能	75.07	171.14	136.82	127.90
产量	67.93	140.56	119.55	93.60
销量	64.58	129.65	109.75	92.56
产能利用率	90.49%	82.13%	87.38%	73.18%
产销率	95.07%	92.24%	91.80%	98.89%

注：产能主要依据生产过程中瓶颈工序设备数量、设备参数、计划生产时间计算；2026 年 1-6 月公司依据实际生产产品价格因素进行了产能折算。

报告期内，公司产量、销量均有所增长，其中产能利用率分别为 73.18%、87.38%、82.13%和 90.49%，公司整体产能利用率处于较高水平，2023 年产能利用率较低主要系受下游阶段性需求波动影响所致。报告期内公司产品的产销率均处于 91%以上，产品销售状况良好。

（五）采购情况

1、主要原材料采购情况

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔及铜球等，公司产品所用原材料种类及型号较多，上游行业技术较为稳定、产品较为成熟、市场充分竞争，主要供应商与公司长期合作，供货及时。

2、主要能源采购情况

报告期内，公司生产所需能源以电力为主，其采购具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电量（万千瓦时）	7,192.30	16,009.39	12,583.31	10,712.66
电费（万元）	4,246.36	8,875.60	7,292.05	7,040.11
用电平均单价（元/千瓦时）	0.59	0.55	0.58	0.66

（六）固定资产和无形资产情况

1、固定资产情况

（1）最近一期末固定资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产（不含固定资产清理）账面原值 165,076.79 万元，累计折旧 55,693.35 万元，账面价值 109,383.43 万元，具体情

况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	20 年	39,634.14	7,584.88	32,049.26	80.86%
机器设备	10 年	122,557.59	46,148.53	76,409.06	62.35%
运输设备	4-5 年	705.00	522.91	182.09	25.83%
电子设备及其他	3-5 年	2,180.05	1,437.04	743.02	34.08%
合计		**165,076.79**	**55,693.35**	**109,383.43**	**66.26%**

（2）主要生产设备情况

公司生产设备主要分布在沙井工厂、松岗工厂、鹤山工厂及泰国工厂四个生产基地，且生产过程中使用到的各种仪器设备品类型号众多，涉及的生产设备主要包含电镀线、曝光机、钻孔机、成型机、蚀刻机、沉铜线及压合机等。

（3）房屋建筑物情况

1）不动产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的不动产情况如下：

序号	权利人	产权证号	坐落地	建筑面积（㎡）	用途
1	鹤山中富	粤（2023）鹤山市不动产权第 0038957 号	鹤山市鹤城镇创利路 59 号之一等	94,694.58	工业用地
2	鹤山中富	粤（2026）鹤山市不动产权第 0021178 号	鹤山市鹤城镇创利路 22 号之十五 102	11,329.57	工业用地
3	聚辰泰国	79830	泰国泰中罗勇工业园	59,469.00	厂房办公楼
4	聚辰泰国	79830	泰国泰中罗勇工业园	7,279.20	污水站
5	聚辰泰国	79830	泰国泰中罗勇工业园	1,781.24	食堂及配套

2）租赁房产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司租赁的房产情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	租赁期间	用途

序号	承租方	出租方	坐落	面积（平方米）	租赁期间	用途
1	公司	何承甫	松岗街道沙浦围村茅洲工业区九号厂区	16,887.66	2024.1.1-2026.12.31	厂房、宿舍
2	公司	深圳市宝安沙井农业发展有限公司	深圳市宝安区沙井街道和一工业区	10,504.61	2025.6.1-2030.5.31	厂房、宿舍
3	公司	深圳市宝安沙井农业发展有限公司	深圳市宝安区沙井街道和一工业区	7,248.00	2023.9.1-2028.8.31	厂房、宿舍
4	公司	深圳市招广置业管理有限公司	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1# 楼 6FGH 单元	650.20	2026.9.1-2029.8.31	办公
5	中富盈创	深圳市荣庆实业有限公司	深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下二路 1 号荣庆大厦 4 层 406 室	148.00	2026.06.08-2028.06.07	办公
6	聚辰电路	一元投资顾问有限公司	中国香港特别行政区新界屯门震寰路 3 号德荣工业大厦 21 楼 C08 室	25.56	2026.7.1-2028.6.30	办公

2、无形资产情况

（1）最近一期末无形资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无形资产账面原值 3,965.33 万元，累计摊销 1,254.82 万元，账面价值 2,710.51 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	摊销年限	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	50 年	1,736.58	567.01	1,169.57
软件	2-10 年	2,228.75	687.81	1,540.94
合计		**3,965.33**	**1,254.82**	**2,710.51**

上述无形资产中，软件系公司外购的生产所需 PCB 设计、生产控制及办公软件，公司相关资产期末不存在减值情形。

（2）土地使用权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司土地使用权情况如下：

序号	使用权人	产权证书	坐落	取得方式	用途	面积（㎡）	终止日期	是否涉及抵押等权利限制
1	鹤山中富	粤（2022）鹤山市不动产权第 0014421 号	鹤山市鹤城镇创利路 59 号之一等	出让	工业	77,116.20	2062.02.06	否
2	鹤山中富	粤（2026）鹤山市不动产权第 0021178 号	鹤山市鹤城镇创利路 22 号之十五 102	出让	工业	53,425.47	2062.02.06	否
3	聚辰泰国	79830	泰国泰中罗勇工业园	受让	工业	52 莱 0 颜 37.4 平方哇（约 8.36 万平方米）	永久（土地所有权）	否

（3）商标

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有注册商标 2 件，公司商标之上未设定质押等权利限制，具体如下：

序号	权利人	商标	注册号	有效期限	注册地	类别
1	中富电路	JOVE	29178372	2019.02.07-2029.02.06	境内	9
2	中富电路	中富电路	29182744	2019.04.14-2029.04.13	境内	9

（4）专利

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司拥有 134 项专利，其中发明专利 14 项，实用新型专利 120 项，公司专利之上未设定质押等权利限制，具体详见“附表：专利”。

（5）著作权登记证书

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有的计算机软件著作权登记证书情况如下：

序号	软件名称	登记号	披露登记日期	取得方式	著作权人

序号	软件名称	登记号	披露登记日期	取得方式	著作权人
1	线路板企业工程 CAM 派单管理系统	2020SR0129454	2020-02-12	原始取得	中富电路
2	线路板品质异常锁定及处理系统	2020SR0129451	2020-02-12	原始取得	中富电路
3	基于图像对比的 PCB 加工产线的质量监控系统	2020SR0128267	2020-02-11	原始取得	中富电路
4	生产工具追溯管理系统	2020SR0127852	2020-02-11	原始取得	中富电路
5	基于互联网的线路板生产信息集成系统	2020SR0126628	2020-02-11	原始取得	中富电路
6	PCB 产品追踪查询系统	2020SR0126537	2020-02-11	原始取得	中富电路
7	出货条码信息比对系统	2020SR0126533	2020-02-11	原始取得	中富电路

（七）发行人特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，发行人无特许经营权。

（八）发行人境外经营的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人共设有聚辰电路、聚慧电子、聚臻电子、聚辰泰国等 4 家境外全资子公司，其中聚辰电路主要负责公司境外 PCB 的销售；聚慧电子、聚臻电子为公司在中国香港地区设立的全资子公司，未开展实质生产经营活动；聚辰泰国为公司于泰国泰中罗勇工业园设立的全资子公司，主要负责境外 PCB 产品的生产与销售。

（九）发行人业务经营资质

发行人及其境内子公司获得境内政府机构颁发的主要经营资质及许可主要包括进出口货物收发货人备案、排污许可证等。公司已经取得从事主要业务相关生产经营活动所必需的备案、注册或者认证等，可以开展相关业务和经营活动。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司发展战略

公司致力于成为先进电力电子及电子电路技术的解决方案商，坚持技术领先、细分应用的发展路线。未来，公司将更加科学地推进全球客户布局，依托通信及数据中心、工业控制、汽车电子、消费电子等下游产业良好的增长态势，持续把握下游领域发展及人工智能技术快速渗透带来的结构性增长机遇。公司始终“秉持专业精神，创新技术，聚焦制造；坚持长期主义，长线规划，永续经营”的理念，肩负“以科技和实业利益社会，富强中国”的时代使命，致力于“成为卓越电子产品的成就与贡献者”的愿景。

（二）公司发展规划

公司将紧紧围绕发展战略，充分依托公司在行业内多年的经验积累和品牌效应，进一步扩大公司在 PCB 领域的生产规模，提升技术水平，积极布局海外市场，全面增强管理效能以及持续盈利能力，具体业务发展安排如下：

1、生产经营计划

2026 年生产经营计划的核心在于国内与国外的双轮驱动战略，旨在全面推动公司整体业务的持续健康发展。在国内，公司将把聚焦产能利用率提升并降本增效，通过优化产品结构、强化内部管理、实施精细化成本控制，并积极进行技术创新，紧跟“高多层、高密度、刚挠结合、高频高速、内埋器件、PSIP”等行业发展趋势，把握人工智能快速发展带来的结构性增长机遇，提升通信及数据中心核心产品占比。在国外，公司将以泰国工厂产能布局为重要抓手，加速推进产线技术改造、新建工厂能力建设与产能爬坡，积极推进海外布局，以拓展国际市场，为公司的快速增长注入新的活力。

2、技术研发计划

公司紧密贴合新能源、数据中心等领域的客户需求和产品方向，开发出了适用于垂直供电 VPD 的模块应用产品、800VHVDC 大电流高耐压高散热场景的高导热高多层 PCB、高功率埋器件车载板、高压车载电源铝基板、三次电源的高阶 HDI、重型车载超厚铜（250-800um)高多层平面变压器、内埋平面电容

和电阻的腔体 MEMS、厚铜细密间距载板等新产品。未来，公司将秉持技术领先、细分应用的发展路线，继续深耕 AI 电源领域，重点聚焦芯片封装电源的技术开发，持续推进高频高速、大电流高导热、埋芯片、埋电感、埋磁、埋电容等新型产品的研发，并将其导入至下一代光模块、MEMS、AI 电源模块等应用，拓展机器人、传感器等其他领域的前沿技术开发，持续为公司的营业收入增长注入新动能。

3、智能制造计划

公司将进一步加快现有工厂的智能化改造与建设步伐，通过自主开发 AI+智能问数、引进 AI 智能报价系统、先进技术和设备，开发知识库等方式提升生产效率和产品质量，持续满足客户的多元化需求。同时，公司泰国工厂进一步提升了智能制造水平，通过优化生产流程、降低能耗和减少浪费，实现单位生产成本的降低，提升整体竞争力。通过不断推进智能化改造和新建工厂的建设，公司将不断提升自身的生产能力和服务水平，为客户提供更加高效、优质、可靠的产品和服务，实现可持续发展。

4、市场营销计划

公司一直秉持“以客户为中心，以市场为导向”的经营策略。经过长期的业务积累，公司已在通信及数据中心、工业控制、消费电子、汽车电子、医疗电子等多个领域积累了一批稳定且优质的国内外客户。未来公司将继续巩固并拓展海外 AI 相关大客户特别是 AI 电源客户，同时深化与国内大客户的合作，优化客户结构，深度洞察并响应客户需求。公司将持续深化现有客户的合作，积极配合开展技术合作研发，实现差异化竞争。公司依托先进的技术实力、优质的产品品质、高效的交货能力、一站式服务体系及国内外制造基地布局等优势，积极开拓海内外市场，进一步扩大公司的目标应用领域版图。此外，公司将进一步加大对新市场的开发；紧密关注高频高速、光电混合、PCB 载板化及先进封装等领域的发展动态，紧跟并力争在部分细分行业引领行业创新步伐，不断扩大市场规模，以巩固和提升公司的核心竞争力，致力于成为先进电力电子及电子电路技术的解决方案商。

5、人才发展计划

公司始终将人才队伍建设置于战略核心位置，不断优化人才结构，致力于打造一支高素质、专业化的人才队伍。公司持续以引进、培养、发展为主线，构建三者相互衔接、协同推进的链式管理体系，实现人才激励与约束机制的有效结合，根据公司业务的发展情况，适时推动股权激励计划，推动员工与公司共同成长，不断提升企业的凝聚力和向心力。在人才管理方面，公司将继续加大优秀人才的引进与培养力度，尤其聚焦高层次人才、技术骨干与管理人才的引进与培养。

六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资的认定标准

根据中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》，对于财务性投资的要求如下：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司存在实施或拟实施的财务性投资业务的情形，具体说明如下：

1、投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资类金融业务的情形。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在从事非金融企业投资金融业务活动的情形。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在与公司主营业务无关的股权投资活动的情形。

4、投资产业基金、并购基金

嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）为公司投资的产业基金。基于谨慎性原则，公司将对其进行的投资认定为财务性投资。该合伙企业首笔

投资 400 万元于 2025 年 9 月实际出资，投资时间在本次董事会前六个月时间范围之外，无需扣减募集资金规模；第二笔投资 600 万元于 2026 年 5 月初实际出资，根据相关规定，该笔投资款属于本次董事会前六个月发生或拟发生的财务性投资。

2026 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议对本次发行的相关议案进行审议，将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 600 万元进行扣减，并更新了本次发行方案。

5、拆借资金、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在对外拆借资金、委托贷款的情形。

6、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司存在使用闲置资金购买短期银行理财的情形，主要是为了提高临时闲置资金的使用效率，以现金管理为目的，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好的低风险的理财产品，具有持有期限短、收益稳定、风险低的特点，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资范畴。

7、拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

综上，自本次发行相关董事会决议日（2026 年 5 月 29 日）前六个月至今，公司存在实施或拟实施的财务性投资的情形，公司已于 2026 年 8 月 28 日召开董事会，将已投入和拟投入的财务性投资金额自募集资金总额中扣减，并更新了本次发行方案，符合财务性投资的相关规定。

（三）最近一期末财务性投资情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的主要会计科目情况如下：

单位：万元

科目	账面价值	是否存在财务性投资	财务性投资金额
其他应收款	821.82	否	-
其他流动资产	12,243.67	否	-
预付款项	360.67	否	-
长期股权投资	489.64	否	-
其他权益工具投资	1,217.39	是	1,000.00
其他非流动资产	3,711.70	否	-
合计	**18,844.89**	/	**1,000.00**

1、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他应收款账面价值为 821.82 万元，主要包括押金及保证金、代扣代缴款项、备用金等，不属于财务性投资。

2、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人其他流动资产金额为 12,243.67 万元，主要为增值税留抵税额，不属于财务性投资。

3、预付款项

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人预付款项为 360.67 万元，主要为预付的货款、能源费用等，不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人长期股权投资账面价值为 489.64 万元，主要为三家参股公司股权，具体如下：

单位：万元

序号	参股公司	主营业务	投资时间及金额	注册资本	实缴资本	持股比例	账面价值	是否为财务性投资
1	迈威科技	PCB 设计与销售	2016 年 1 月支付股权款 350.00 万元	1,127.86	1,127.86	4.93%	434.84	否

序号	参股公司	主营业务	投资时间及金额	注册资本	实缴资本	持股比例	账面价值	是否为财务性投资
2	银方新材	PCB 表面处理材料研发、生产与销售	2017 年 6 月支付投资款 22.00 万元	333.00	333.00	6.61%	54.81	否
3	中为封装	先进封装技术的研发、生产与销售业务	2022 年 11 月支付投资款 400 万元	1,000.00	1,000.00	40.00%	-	否
合计				**2,460.86**	**2,460.86**	/	**489.64**	否

（1）迈威科技

迈威科技经营范围为电子产品、计算机软件的技术开发、设计与销售，国内贸易以及货物及技术进出口，其核心业务为 PCB 版图设计及配套技术服务。PCB 版图设计以电路原理图为基础，需综合考量外部连接布局、元器件排布、走线与通孔设计、电磁防护、散热管控等多重要素，是实现电路板功能的前置关键环节。迈威科技已在标准化板卡输出、模块封装领域实现规模化落地，同时开展新能源产品的测试开发，提供测试系统及整体解决方案，属于 PCB 制造行业的上游环节。

报告期内，中富电路对迈威科技的股权投资，系围绕产业链上游开展的产业战略投资，投资目的为深化双方技术协同、拓展客户资源，并非以获取单纯财务收益为主要目的。迈威科技的主营业务、研发方向与公司 PCB 制造主业具备较高业务关联度，该投资属于围绕产业链上下游获取技术、业务资源的产业投资，不属于财务性投资。

（2）银方新材

银方新材设立于 2017 年，由方斌、潘海平及中富电路共同发起设立，其中中富电路认缴出资 22.00 万元，持股比例 6.61%，相关出资已于 2017 年完成实缴。银方新材主要从事 PCB 领域表面处理材料的研发、生产与销售，核心产品包含应用于印制电路板的热敏电阻，标的企业目前生产经营状况正常。

报告期内，银方新材的主营业务及研发方向归属于 PCB 制造的上游原材料环节。中富电路对银方新材实施股权投资，系面向产业链上游开展的产业战略布局，投资目的在于强化上游材料端的产业协同，更好对接原材料技术迭代，

非以获取单纯财务回报为主要目标。该标的业务方向与公司 PCB 制造主业具备较高的关联度，因此本次股权投资属于产业链上下游产业投资，不属于财务性投资。

（3）中为封装

中为封装成立于 2022 年 5 月，由深圳市唯亮光电科技有限公司和中富电路共同发起设立，中富电路认缴 400.00 万元，持股比例 40.00%，股权款已于 2022 年 11 月实缴完成。中为封装经营范围涵盖电子专用材料研发及销售、集成电路设计与销售、电子元器件批发、以自有资金从事投资活动、各类技术开发与技术服务等，核心聚焦半导体系统级封装模组的研发与制造业务。

当前中富电路正大力推进封装载板产业化落地，重点开展有机封装基板的研发及量产工作；中为封装则侧重引线框架生产、封装工艺技术研发，双方业务具备较强的产业互补性。公司参股中为封装，旨在实现双方在技术研发、品质管控、下游客户验证等维度的深度协同，助力公司封装基板业务规模化发展，夯实技术储备、丰富产品矩阵。该投资紧密围绕公司 PCB 及封装载板主业开展，属于产业链布局下的产业战略投资，不属于财务性投资。

综上，截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有的长期股权投资均符合公司产业链一体化布局的规划，可以与公司主营产生较好的协同效应，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

5、其他权益工具

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他权益工具为公司投资嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）1,000 万元以及深圳市唯亮光电科技有限公司 217.39 万元，其中公司对深圳市唯亮光电科技有限公司的投资是基于产业链上下游的投资，该笔投资不属于财务性投资；公司对嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）的投资基于谨慎性原则，认定为财务性投资，具体分析如下：

1）深圳市唯亮光电科技有限公司（以下简称“唯亮光电”）

唯亮光电成立于 2016 年 6 月，主营半导体及光电器件封装材料的研发与制造。发行人持有唯亮光电 1%股权，并与唯亮光电于 2022 年合资设立中为封装。发行人对唯亮光电、中为封装的投资，旨在与合作方在封装技术研发、产品品质管控、下游客户验证等方面形成业务协同，助力公司封装基板业务实现规模化落地，持续积累半导体封装领域 PCB 相关技术、丰富产品矩阵，属于基于 PCB 工艺技术与下游客户验证而进行的产业化投资。因此发行人对唯亮光电及中为封装的参股投资，系为深化产业合作开展的战略布局，不属于财务性投资。

2）嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）为公司进行的产业基金投资，截至目前该产业基金仅对外投资一家公司西安戴维新材料有限公司。公司对该合伙企业认缴金额 1,000 万元，其中 400 万元于 2025 年 9 月实缴，剩余 600 万元于 2026 年 5 月实缴。基于谨慎性原则，公司将针对嘉兴湃圃春之阳创业投资合伙企业（有限合伙）的投资认定为财务性投资。

6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的其他非流动资产主要为预付的设备款及工程款，均与公司目前的工程建设相关，不属于财务性投资。

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有财务性投资合计金额为 1,000 万元，占公司归母净资产的 0.61%，该比例较低，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

七、诉讼、仲裁及行政处罚情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。发行人及其子公司相关重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况如下：

（一）重大诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司不存在涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且金额超过 1,000 万元尚未了结的重大诉讼、仲裁事项。

（二）行政处罚情况

报告期内，发行人及其子公司受到罚款一万元以上的行政处罚情况如下：

序号	行政机关	处罚对象	文件名称	处罚时间	处罚事由	处罚措施
1	深圳市宝安区应急管理局	发行人	(深宝) 应急罚(2023) 51 号	2023 年 3 月 16 日	未对安全设备进行定期检测（烤箱房的可燃气体浓度检测报警装置共 5 台未年检）	罚款 4.00 万元

2023 年 3 月，因发行人未对安全设备进行定期检测（烤箱房的可燃气体浓度检测报警装置共 5 台未年检），深圳市宝安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项之规定，并参照《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020 年版）（调整补充）》违法行为编号 1013 项，向发行人下发了《行政处罚决定书》（（深宝）应急罚[2023]51 号），对发行人作出人民币 4.00 万元罚款的行政处罚。

公司收到上述行政处罚决定后依法缴纳了罚款，且及时寻求有资质的检测公司开展相关安全设备检测。为了避免再次出现类似违法违规情形，公司健全了有关安全生产等的管理制度，对安全生产的环节进行详细规定；加强对相关岗位员工安全生产意识及安全生产知识的学习，督促其严格按照相关规定开展业务，对相关事项进行了有效整改。

鉴于该处罚不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的情节严重的情形，不属于导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣或严重损害发行人及投资者合法权益的情形，亦未对发行人的生产经营造成重大不利影响。该行政处罚事项不构成发行人本次发行的实质性障碍。

除以上事项以外，报告期内公司及子公司不存在其他与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。

八、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况

报告期内，深交所创业板公司管理部就公司 2023 年年度报告、2024 年年度报告及 2025 年年度报告进行了问询，上述问询函涉及的问询事项主要包括公司年度业绩波动原因、前次募投项目未达预期效益的原因等。公司已会同年审会计师就上述相关问题进行了逐项落实并回复。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、“十五五”规划纲要为 PCB 产业迈向高端化、数智化发展奠定了良好的政策基础

2026 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，为印制电路板（PCB）产业向高端化、数智化、绿色化高质量发展奠定了良好的政策基础。规划纲要强调发展新质生产力、提升数智化发展水平，明确提出推进电子信息全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。此举将推动 PCB 行业企业在高层数、高密度、高可靠性等核心技术领域持续突破，促进 PCB 产品结构向适配 AI 服务器、新一代通信等高端应用领域的高多层板、高阶 HDI 板加速升级。在数智化发展方面，规划纲要提出深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，为 PCB 行业智能制造与数智化转型提供技术路径指导。同时，规划纲要鼓励企业提高绿色设计和制造水平，降低产品全生命周期能源资源消耗和生态环境影响，为 PCB 行业构建产品全生命周期绿色管理体系、开展节能环保工艺创新提供政策指引。

在此政策框架下，我国 PCB 产业依托完备的产业配套体系与国家战略导向，深度融入全球人工智能算力基础设施供应链体系，将加速向高端化、数智化、绿色化高质量发展迈进。

2、下游高端 PCB 需求持续增长，驱动 PCB 行业向高端化与数字化转型升级

近年来，受益于人工智能技术持续迭代，AI 服务器、数据中心等算力基础设施建设进程加快，AI 服务器、高性能计算及网络通信设备迎来新一轮发展机

遇，叠加汽车电动化、智能化渗透率提升带动的市场需求增长，全球 PCB 市场规模呈现稳步增长态势。根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 产值为 858.36 亿美元，同比增长 16.68%；预计至 2030 年，全球 PCB 市场规模有望达到 1,446.11 亿美元。其中，受益于 AI 算力基础设施建设提速，HDI 板、高多层板等高端 PCB 产品市场需求增长相对较好，2025 年全球 HDI 板产值同比增长 29.4%，高多层板产值同比增长 19.3%。

伴随 AI 服务器、高速通信、汽车电子等下游应用领域对 PCB 产品层数、孔径精度及可靠性要求逐步提高，促使 PCB 产品持续向高端化发展；同时，高多层板、高阶 HDI 板对制程工艺的严苛标准，亦推动行业内企业加快推进数字化改造升级，通过部署 MES、WMS 等核心信息系统，实现生产数据实时采集、工艺参数精准管控及产品全流程质量追溯，逐步构建柔性化生产调度能力。因此，全球 PCB 行业竞争模式正逐步由传统产能规模竞争，向数字化管控能力、高端制造能力的综合竞争转型，进而推动行业生产工艺及运营管理体系不断优化升级。

3、依托政策与行业发展机遇，公司亟需加快高端化与数智化升级提升核心竞争力

公司凭借长期技术积累与高效的客户服务体系，在通信、工业控制、汽车电子、消费电子及半导体封装等核心领域积淀了稳定优质的客户资源，已与多家全球领先的通信及数据中心设备服务商、Flex Power、MPS、台达、瑞萨、TI、ADI、muRata、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Jabil、比亚迪、瑞声、歌尔、立讯等众多境内外行业知名企业建立长期稳固的深度合作关系。同时，公司紧抓 AI 产业发展机遇，加大 AI 用 PCB 市场开拓力度，已顺利通过多家头部客户供应商认证，成功切入台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、沛塬电子、美国芯源（MPS）等 AI 服务器客户供应链，并与境外大型云厂商及其供应链企业开展试样验证、联合研发与新品预研，为布局全球 AI 算力基建市场筑牢根基。

为充分把握下游高端 PCB 需求快速增长的战略机遇，公司亟需加快产品结

构优化、深化数字化与智能制造升级，进一步补强高端产能与精细化管控能力，全面提升核心竞争力，以抢抓下游市场需求机遇。

（二）本次发行的目的

1、加速 AI 用 PCB 高端印制电路板布局，抢抓下游市场需求机遇

当前全球电子设备持续向智能化、高性能、高功率、小型化方向迭代升级，下游 AI 服务器电源、通信设备、工业控制、高速通信等领域需求持续旺盛，带动高端印制电路板市场需求稳步释放。其中，AI 服务器电源配套 PCB、高速通信 PCB 作为核心配套组件，需求增速相较突出。为加强巩固与下游领域核心客户的合作粘性，扩大公司在高端 PCB、AI 服务器电源 PCB 及高速通信 PCB 领域的市场份额，公司加速 AI 用 PCB 高端印制电路板布局，新增高端 PCB 产能并持续优化公司现有产品结构，抢抓下游市场需求机遇。

2、顺应行业数字化转型趋势，提升公司精细化管理水平与综合竞争力

当前，PCB 行业竞争格局已由传统产能规模竞争，逐步转向数字化管控能力、产品品质保障能力及综合运营效率的竞争，行业内领先企业已率先实施智能制造与数字化体系布局。公司通过对现有信息化基础实施数字化升级，构建一体化数据管控平台，实现生产过程透明化管控与全流程质量追溯，补齐公司数字化运营短板，提升整体运营管理效率与精细化管理水平，缩小与行业领先企业的数字化差距，进一步巩固并提升公司市场地位与综合竞争力。

3、优化公司资本结构，提升可持续发展能力

本次募集资金到位后，公司的资产总额将得到一定程度的增加，公司整体的资本实力进一步提升。公司资产负债率将会下降，资本结构得到优化，有利于降低公司的财务风险。随着公司业务规模的不断扩大，未来阶段对流动资金的需求将持续增加，存量资金也将难以满足业务拓展的需要。本次发行的募集资金部分用于补充流动资金，将在一定程度上解决公司上述问题，缓解业务发展对公司营运资金带来的压力，提高公司偿债能力、抗风险能力和公司资本实力，增强公司核心竞争力，支持公司可持续发展。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先、金额优先等原则确定。

截至本募集说明书公告日，公司本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。本次发行的发行对象与公司之间的关系将在发行完成后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

三、本次向特定对象发行股票方案概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以

及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

（四）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：

派息：P1=P0-D；

送股或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积转增股本数，P1 为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得中国证监会的同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格最终确定，且不超过

本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 57,429,039 股（含本数）。本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会同意注册的批复文件为准，最终发行数量由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股票数量上限将根据深交所和中国证监会相关规定进行相应调整。

（六）股票限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。

（八）募集资金用途及数额

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 84,400.00 万元（含本数，已扣除本次发行首次董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目	74,020.52	60,000.00
2	数字化升级建设项目	12,763.01	8,000.00
3	补充流动资金	16,400.00	16,400.00
合计		**103,183.53**	**84,400.00**

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额

进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

（九）滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

（十）发行决议有效期

本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票相关决议之日起 12 个月之内。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人通过中富电子、中富兴业、睿山科技、泓锋实业、香港慧金等主体合计间接控制发行人 62.31%股份。假设本次发行按照股票数量上限（本次发行前公司总股本的 30%，即 57,429,039 股）测算，本次发行完成后，王昌民、王璐、王先锋合计控制公司的股权比例为 47.93%，仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

六、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准

的程序

本次向特定对象发行方案已经公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议以及 2026 年第一次临时股东会审议通过，根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。在获得中国证监会注册后，公司将依法实施本次向特定对象发行股票，向深交所和中国结算深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

上述呈报事项能否获得同意，以及获得同意的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 84,400.00 万元（含本数，已扣除本次发行首次董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目	74,020.52	60,000.00
2	数字化升级建设项目	12,763.01	8,000.00
3	补充流动资金	16,400.00	16,400.00
合计		**103,183.53**	**84,400.00**

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目

1、项目概况

为积极响应国家产业政策，加速布局 AI 服务器及高端算力硬件领域高端印制电路板业务，全面提升公司核心竞争力与行业地位，公司拟在广东鹤山投资建设 AI 用 PCB 产线改扩建项目，本项目由发行人全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施，总投资额为 74,020.52 万元。本项目紧密围绕公司主营

业务开展，可以强化公司在 AI 高端算力、数据中心基础设施等场景的产品供给与技术支撑，持续提升公司在高端 PCB 赛道的综合竞争力，增强公司的盈利能力与长期发展潜力。

2、项目必要性

（1）积极响应国家产业政策，助力公司高端化转型，提升产业链竞争力

近年来，国家高度重视新一代信息技术产业发展，先后出台《电子信息制造业数字化转型实施方案》《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》《制造业数字化转型行动方案》等一系列政策，明确支持推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。印制电路板行业作为电子信息产业的核心基础元器件是支撑电子信息设备发展的关键载体，逐步向高端化、智能化、绿色化转型，其高端化发展直接关系到下游电子信息产业的核心竞争力。

公司作为国内 PCB 行业的骨干企业，始终紧跟国家产业政策导向，积极践行产业升级责任，进行高端 PCB 产品研发与生产。本次鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目，聚焦 AI 服务器电源、算力基础设施、智能汽车等高端 PCB 产品，同步布局精密制造、系统集成（器件埋入）、厚铜载板功率传输等技术储备，契合国家 PCB 行业高端化、自主化发展战略，既是公司响应产业政策的具体举措，也是加速高端技术突破与产能落地的关键行动，推动国内 PCB 行业突破高端技术壁垒、提升产业链整体竞争力。

（2）紧跟下游市场需求机遇，匹配战略客户订单增长，突破高端产能瓶颈

当前全球电子设备向智能化、高性能、高功率、小型化方向迭代升级，下游 AI 服务器电源、工业控制、高速通信等领域需求持续旺盛，带动高端印制电路板市场需求稳步释放。作为国内 PCB 行业的核心企业之一，公司凭借多年的技术积累与品质管控，已深度绑定台达电子、威迈斯、嘉龙海杰、比亚迪、Vertiv 等全球头部电源或汽车厂商，建立了长期稳定的战略合作关系，成为 AI 服务器电源 PCB 产品、高速通信、智能汽车产品的核心供应商。随着下游客户业务规模的持续扩张，其对高端 PCB 产品的采购需求逐年攀升，而公司现有高

端产能已处于饱和状态，已无法满足核心客户批量订单的及时交付需求，产能瓶颈已成为制约公司进一步拓展高端市场、巩固客户合作关系的关键因素。

本次鹤山中富 PCB 产线改扩建项目，业务重心聚焦 AI 服务器电源 PCB 核心赛道，同时统筹布局高速通信 PCB 产能储备，产品定位贴合下游行业发展趋势，精准对接主流核心客户实际订单诉求。项目依托厂区现有生产设施开展设备升级、工艺优化与产线改造，稳步扩充高端 PCB 有效产能，进一步调整完善整体产能结构，切实缓解目前高端产品产能供给不足的发展瓶颈。项目建成投产后，能够有效提升订单处理效率，保障产品交付时效与供货品质稳定性，持续加深与核心客户的合作联结，稳固现有合作关系。依托产能实力提升，公司可进一步紧跟重大市场机遇，扩大自身在 AI 服务器电源 PCB 细分领域的市场占有率，全面增强综合市场竞争力，为企业中长期业务稳步扩张、经营规模持续增长夯实产能根基。

（3）优化公司产能布局，推动高端技术突破，破解行业同质化竞争困境

当前国内 PCB 行业呈现明显的两极分化格局，中低端 PCB 市场同质化竞争激烈，产品附加值偏低，盈利能力持续承压；而高端 PCB 市场由于技术壁垒高、研发投入大、生产工艺复杂，行业准入门槛较高，目前供给缺口较大，尤其是 AI 服务器电源 PCB、封装载板、高速通信 PCB 等高端细分领域，核心技术与优质产能主要集中于少数头部企业，市场竞争格局相对宽松。公司深耕 PCB 行业多年，已在深圳、江门、泰国布局多个生产基地，形成了一定的产能规模与区域协同优势。

鹤山中富 AI 应用 PCB 产线改扩建项目建成后，能够进一步补齐公司高端 PCB 产能布局短板，统筹协调各生产基地分工定位，实现产能资源统筹调配与优势互补，全面提升整体生产运营效率。项目重点开展 AI 服务器电源 PCB 产品规模化生产。依托产线升级契机，公司将加大高端印制电路板技术研发投入，持续优化高阶 HDI、厚铜板材、高多层线路板、高频高速板材及内埋器件加工等核心工艺，稳步精进高端产品研发实力与智能制造水准，带动产品品类向高附加值方向进阶，依托差异化竞争优势推动企业实现稳健高质量发展。

基于上述条件，公司管理层经过充分调研与审慎研究，认为本次募集资金投资项目的实施将进一步优化公司产品结构、增强公司市场竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目的实施具备必要性。

3、项目可行性

（1）友好的产业政策为本项目实施提供良好的政策环境

印制电路板（PCB）作为各类电子系统不可或缺的基础互联载体，是支撑数字经济、新型工业化与电子信息产业自主可控的战略性、基础性、先导性支柱产业，长期受到国家产业政策的重点扶持与引导。国家“十四五”规划明确提出加快壮大新一代信息技术、新能源汽车、人工智能、工业互联网等战略性新兴产业，为 PCB 行业提供了长期发展框架。在此基础上，国务院及各部委先后出台《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》《关于培育壮大新质生产力推进新型工业化的指导意见》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》《电子信息制造业数字化转型实施方案》等一系列政策，持续推动高速通信、新能源汽车、物联网、工业互联网、算力基础设施等 PCB 下游应用领域快速升级，提出加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，打造新兴支柱产业，加快航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，并推动具身智能、第六代移动通信等未来产业成为新的经济增长点。

近年来，PCB 行业政策进一步向高质量、高端化、绿色化聚焦，工信部发布《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》《印制电路板行业高质量发展行动计划（2025—2028 年）》，引导行业严控低端产能扩张、强化研发创新、提升绿色制造与智能制造水平，推动 PCB 向高频高速、高阶 HDI、高多层、IC 载板、AI 服务器板等高端方向升级。多层次政策体系协同发力，持续拓宽 PCB 市场需求空间、优化行业竞争格局，为我国 PCB 产业高质量发展与国产替代提供了坚实支撑与长期有利的发展环境。

（2）优质的客户资源为项目产能消化奠定稳定的市场基础

公司凭借技术逐步积累和与客户的长期合作，在通信、工业控制、汽车电子、 消费电子、半导体封装等领域拥有了较为稳定的客户资源，与众多国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。目前公司与多家全球领先的通信及数据中心设备服务商、Flex Power、MPS、台达、瑞萨、TI、ADI、muRata、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Jabil、比亚迪、瑞声、歌尔、立讯等通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域的国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。

为了加大对 AI 用 PCB 市场的开发力度，公司陆续通过了多家知名客户的供应商认证体系认证，成功开拓了诸如台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、沛塬电子、美国芯源（MPS）等多家 AI 服务器客户，同时与多家境外大型云厂商客户及其供应商进行了富有成效的接触、试样及联合研发，参与大客户新产品预研，为本次项目的实施奠定了稳定的市场基础。

（3）深厚的技术积淀为项目建设提供重要保障

公司深耕 PCB 领域多年，针对 AI 硬件高功率密度、精密散热、异构集成的核心需求，已构建起贯穿原材料加工、器件级封装至系统集成的全链条核心技术体系，在 AI 电源板精密制造、厚铜载板功率传输、埋器件系统集成等领域形成关键技术储备，相关技术已实现精密尺寸控制、小间距线路、器件嵌埋等核心突破，为本次募投项目建设及顺利实施提供了坚实的技术保障，有效保障项目技术可行性。

公司在精密制造（含 PCB 平面度、尺寸公差控制）、功率传输（厚铜线路优化）、系统集成（器件埋入）等核心技术领域已实现关键突破，相关技术已具备规模化生产条件，能够精准匹配本次募投项目高端 AI 服务器电源相关产品的技术要求，有效降低项目技术落地风险，进一步夯实项目可行性基础。依托成熟的技术积淀与规模化生产经验，公司可快速实现募投项目产能释放、产品稳定交付，确保项目投产后能够顺利达成预期目标，为公司项目建设提供了坚实的技术保障。

4、项目投资情况

本项目预计总投资为 74,020.52 万元，拟使用募集资金投入金额 60,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	**建设投资**	**73,068.13**	**98.71**	60,000.00
1.1	场地购置费	3,113.64	4.21	
1.2	装修及配套工程费	4,379.51	5.92	
1.3	设备购置及安装	64,289.20	86.85	
1.4	设备安装费用	1,285.78	1.74	
二	**工程建设其他费用**	**952.39**	**1.29**	
三	**合计**	**74,020.52**	**100.00**	**60,000.00**

本次发行董事会决议前，该项目土地购置费已完成部分投入。该项目拟使用募集资金投入金额为 60,000.00 万元，募集资金计划用于建设投资中的场地购置费及设备购置费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

5、项目实施主体

本项目由发行人全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施。

6、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目计划实施周期为 24 个月，项目于计算期第 5 年（含建设期）达到满产状态，项目整体建设进度安排如下：

序号	项目	T1（年）				T2（年）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购买及清理场地	■	■						
2	工程及设备招标		■	■					
3	基础建设及装修工程		■	■	■	■	■		
4	设备采购及安装调试			■	■	■	■	■	■
5	人员招聘及培训				■	■	■	■	■
6	试生产						■	■	■
7	验收竣工							■	■

7、项目效益预测情况

本项目包括建设期在内的效益测算期为 11 年，其中建设期 2 年。本项目运营期可实现年均营业收入 70,044.44 万元，年均净利润 8,576.81 万元，预期经济效益良好。该项目的效益预测的假设条件和计算过程具体如下：

（1）销售收入预测

1）销售价格

本项目产品类型规划方面，根据 AI 服务器通常采用的三级递进供电架构，将电源 PCB 沿供电链路划分为一次、二次、三次层级。一次电源将外部交流电 AC 或高压 DC 转换为服务器内部直流母线电压，属于一级能量转换环节；产品功率等级高，对散热设计与绝缘耐压要求较高；二次电源将一次电源输出的直流母线电压转换为中间电压，属于二级能量分配环节；侧重保障电压输出稳定性与功率传输效率；三次芯片电源将中间电压进一步降压至芯片级工作电压，直接为 GPU、CPU、ASIC 等核心芯片供电，属于末端精准调压环节；强调高频动态响应能力与小型化集成设计。本次募投项目产品全面覆盖一、二、三次电源 PCB，可完整匹配 AI 服务器高功率、高可靠性的供电配套需求。

根据项目《可行性研究报告》，本项目的主要产品以一次、二次、三次 AI 服务器电源板为主，预计销售价格分别为 2,200 元/㎡、7,500 元/㎡、10,000 元/㎡，该价格以本项目《可行性研究报告》出具时点公司报告期内已销售产品平均销售价格为主要参考依据。

2）产品产量预测

根据本项目的可行性研究报告，本项目在达产后产能将逐步释放，在第三年至第五年项目产能利用率分别为 40%、60%及 100%，满产状态下将形成年产 12 万平方米 AI 服务器电源 PCB 板的新增产能。

3）产品销售收入

根据本项目《可行性研究报告》，基于以上产品类型和价格，本项目达产后运营期将实现年均销售收入为 70,044.44 万元。

（2）成本预测

本项目主要成本费用估算依据如下：

1）直接材料

在本项目效益测算中，主要产品单位材料成本占收入的比例以公司 2025 年销售产品平均单位材料成本占收入的比例作为参考依据进行测算。

2）直接人工

本项目主要人员包括生产人员、销售人员、技术人员及管理人员，项目合计定员人数 600 人，人员工资水平以公司目前的人员平均产值为基础，同时参考同行业 AI 服务器相关 PCB 产品销售公司的人均产值水平进行计算得出。

3）折旧及摊销

本项目的折旧摊销按公司现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行计提：

资产类别	本项目折旧摊销政策		
	估计使用年限	净残值率	年折旧摊销率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%

根据本项目的可行性研究报告，预计本项目达产期年均折旧摊销额 5,908.87 万元。

4）其他制造费用

本项目其他制造费用参考公司历史年份其他制造费用占生产成本的比例均值计算。

（3）销售费用、管理费用、研发费用预测

本项目销售费用、管理费用、研发费用主要参考公司历史年份相关费用率平均水平上调 10%测算。

（4）所得税费用预测

本项目所得税按照税率 15%测算。

（5）募投项目效益测算合理性分析

根据上述测算，在产销平衡状态下，本项目运营期将实现年均营业收入 70,044.44 万元，销售毛利率为 24.95%，具体指标如下：

序号	指标名称	指标值	备注
1	销售收入（万元）	70,044.44	运营期
2	净利润（万元）	8,576.81	运营期
3	销售毛利率（%）	24.95	运营期
4	税后内部收益率（%）	10.84	/
5	税后投资回收期（年）	8.12	含建设期，静态

（6）公司及同行业效益指标比较情况

本项目目标产品的毛利率与公司 2025 年至 2026 年 1-6 月同类产品销售毛利率对比情况如下：

毛利率	2026 年 1-6 月	2025 年度	本次募投项目毛利率
一次电源板	32.49%	36.68%	24.95%
二次电源板	34.98%	33.30%	24.95%
三次电源板	65.29%	28.94%	24.95%

如上表所示，本次募投项目三类 AI 服务器电源产品毛利率均低于公司已实现的相关产品销售毛利率，具有谨慎性及合理性。根据同行业公司公告数据整理，同行业公司 AI 相关 PCB 募投项目的效益指标情况如下：

证券简称	项目名称	毛利率	内部收益率	静态回收期（含建设期，年）
胜宏科技	越南胜宏人工智能 HDI 项目	25.03%	15.18%	7.69
生益电子	人工智能计算 HDI 生产基地建设项目	26.95%	14.20%	7.55
	智能制造高多层算力电路板项目	22.49%	12.57%	8.40
奥士康	高端印制电路板项目（AI 服务器、AIPC、汽车电子等多个新兴应用领域）	24.77%	11.72%	8.36
科翔股份	智恩电子高端服务器用 PCB 产线升级项目	20.04%	15.48%	6.43
强达电路	南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目	29.58%	18.05%	8.07

证券简称	项目名称	毛利率	内部收益率	静态回收期（含建设期，年）
方正科技	人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	25.00%	10.46%	8.52
平均值		**24.84%**	**13.95%**	**7.86**
中富电路	**本次募投项目**	**24.95%**	**10.84%**	**8.12**

与同行业公司近年来的募投项目效益数据相比，本项目的效益测算结果较为谨慎、合理。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

8、公司既有业务发展概况及扩大业务规模的必要性、新增产能规模的合理性

（1）公司既有业务发展概况及扩大业务规模的必要性

本次募投产能规划具备充分合理性。当前 AI 算力基础设施建设速度迅猛，AI 服务器电源 PCB 的客户需求量快速攀升，属于行业高景气赛道，多家同业上市公司持续加码相关高端产能布局。本次鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目拟新增 12 万平方米产能，聚焦 AI 服务器电源 PCB 细分领域，属于高端产能升级，与公司现有常规 PCB 产能形成差异化互补。报告期内，公司持续推进高端产品客户验证，AI 服务器电源产品已实现批量供货、在手订单充裕，叠加成熟的技术研发与管理运营团队支撑，新增高端产能布局契合下游市场长期发展趋势，公司本次扩产项目建设具备必要性。

（2）新增产能规模的合理性

1）下游应用领域需求持续增长，为产能消化奠定良好的市场基础

公司已顺利通过台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能等多家 AI 产业链核心供应商的资质认证，AI 服务器电源 PCB 已实现批量供货；公司持续深化与现有客户的协同合作，深度参与客户新产品前期预研项目，同步跟进客户 AI 服

务器电源产品迭代需求，稳定获取持续性量产订单，为新增产能落地提供坚实的订单支撑。截至 2026 年 6 月末，公司 AI 服务器电源相关产品在手订单规模充足，能够有效支撑项目达产后的增量产能。

2）优质的客户资源为项目建设提供了有力支撑

目前公司与多家全球领先的通信及数据中心设备服务商、Flex Power、MPS、台达、瑞萨、TI、ADI、muRata、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、Jabil、比亚迪、瑞声、歌尔、立讯等通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域的国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。

为了加大对 AI 用 PCB 市场的开发力度，公司陆续通过了多家知名客户的供应商认证体系认证，成功开拓了诸如台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、沛塬电子、美国芯源（MPS）等多家 AI 服务器客户，同时与多家境外大型云厂商客户及其供应商进行了富有成效的接触、试样及联合研发，参与大客户新产品预研，为本次项目的实施奠定了稳定的市场基础。

3）坚持技术迭代创新，构筑长期竞争壁垒

公司紧跟全球 AI 算力基础设施持续扩容的行业发展趋势，持续深耕 AI 服务器电源 PCB 领域工艺研发与技术迭代，围绕产品散热性能、阻抗控制、长期运行可靠性持续开展技术攻关，持续强化公司在电源类 PCB 赛道的核心竞争力。依靠技术优势深化长期战略合作关系，提升客户粘性，持续挖掘下游算力硬件升级带来的增量需求，保障新增产能中长期有序消化。

综上所述，鉴于全球 AI 算力基础设施持续扩容，AI 服务器电源 PCB 需求量激增，公司拥有丰富的客户资源储备、在手订单和技术积淀，可以保障募投项目的顺利实施与产能消化，本次新增产能规模具备合理性。

9、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进行、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

截至本募集说明书签署日，公司已取得本项目的备案文件《广东省企业投

资项目备案证》（项目代码 2608-440784-04-02-124426）。

本项目已取得广东省生态环境厅下发的“粤环审[2019]575 号”、江门市生态环境局下发的“江鹤环审[2026]58 号”环评批复文件。

公司已取得用于本项目建设的不动产权证书，即鹤山市自然资源局出具的粤（2026）鹤山市不动产权第 0021178 号、粤（2023）鹤山市不动产权第 0038957 号不动产权证书。

（二）数字化升级建设项目

1、项目概况

本项目拟依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级。本项目拟由发行人及其全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司作为实施主体，总投资额为 12,763.01 万元，项目规划建设期为 24 个月。通过对核心功能模块的迭代优化与补充完善，推动数字化管理在公司全业务链条实现全域覆盖与深度渗透，助力公司持续强化精细化管理，并在此基础上强化产品全流程品质追溯能力，持续提升产品良率与制程稳定性，进而优化内部管理流程、降低综合运营成本，提升生产环节协同效率及公司整体运营管控水平。同时，本项目拟通过搭建智慧园区系统及园区配套机房建设，构建全方位、多层次的信息安全防护体系，增强数据资产安全与系统运行稳定性，夯实公司数字化运营的底层技术基石，为公司业务高效、稳健运行提供坚实支撑，助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。

2、项目必要性

（1）加强数字化能力升级建设，提升全流程追溯与柔性调度能力

公司专注于印制电路板的研发、生产与销售，产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等核心领域，具备定制化程度高、产品品类丰富、订单交付周期短的经营特征。目前，公司境内外生产基地信息化体系仍处于基础建设并持续完善的阶段，各业务模块系统尚未实现深度数据协同，制程数据采集与品质追溯的精细化程度仍存在优化空间。本项目拟通过生产环节数字化升级建

设，搭建覆盖订单接收、制程管控、成品出库全链条的数据采集与质量追溯体系，优化柔性化生产调度体系，全面提升公司对定制化订单的快速响应能力与产品交付品质，适配 PCB 产品高频、高速、高密度的高端化发展趋势。

（2）顺应行业数字化转型趋势，全面提升精细化管理水平与综合竞争力

当前 PCB 行业竞争格局已由传统产能规模竞争，转向数字化管控能力、产品品质保障能力及综合运营效率的竞争，行业内领先企业已率先完成智能制造与数字化体系布局。同时，伴随 AI 服务器、高速通信等下游高端应用领域对 PCB 产品层数、工艺精度及可靠性要求持续提升，产品生产制造复杂度日益提升，对企业全流程精细化管理提出更高要求。公司产品种类丰富、定制化程度较高，现已形成涵盖境内外生产的多基地运营格局，对跨部门、跨基地协同管理及资源统筹调度的依赖程度较高。本项目拟通过对现有信息化基础实施数字化升级，整合 MES、WMS、QMS、ERP 等核心业务系统，构建一体化数据管控平台，实现生产过程透明化管控与跨基地资源高效协同调度，补齐公司数字化运营短板，提升整体运营管理效率与精细化管理水平，缩小与行业领先企业的数字化差距，进一步巩固并提升公司市场地位与综合竞争力。

（3）优化成本管控体系，提升运营效率及综合盈利能力

公司 PCB 产品生产工序较长、工艺技术复杂度较高，成本管控贯穿研发设计、物料采购、生产制造及质量管理等全业务流程。目前公司已形成境内外多生产基地协同布局，其中鹤山生产基地获评“江门数字化转型标杆车间”，数字化建设具备阶段性示范成效；泰国生产基地在建设阶段同步部署 MES、WMS 等核心数字化系统，初步实现订单流转、制程追溯及物流协同等基础功能。尽管公司在数字化转型方面已取得阶段性进展，但各业务系统间的数据协同效率仍有优化空间。基于以上，本项目拟通过生产流程优化、管理系统迭代升级及供应链数字化建设，推动核心业务系统间数据贯通，实现从订单接收到成品出库的全流程数据互联互通，提升资源配置效率与跨基地、跨部门流程协同效能，持续优化产品交付能力，提升高附加值产品占比，增强应对原材料价格波动的成本管控能力，进而提升公司综合盈利能力。

（4）强化信息安全建设，支撑业务高效稳定运转

伴随公司数字化程度提升，生产数据、客户信息、工艺参数等核心数据资产规模持续增长，对信息安全保障能力提出更高要求。本项目拟通过搭建智慧园区系统及园区配套机房建设，完善数据备份、权限管理、网络安全防护机制，构建全方位、多层次的信息安全防护体系，增强数据资产安全与系统运行稳定性，夯实公司数字化运营的底层技术基石，为公司业务高效、稳健运行提供坚实支撑，助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。

综上所述，本次募集资金投资项目具有合理性和必要性。

3、项目可行性

（1）国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境

近年来，我国陆续出台相关政策支持制造业数字化转型，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026 年）》提出把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，加快数智技术创新；《信息化和工业化融合 2025 年工作要点》明确推进数字化转型，引导规上工业企业、专精特新中小企业加快数字化改造；《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》要求深入推动数字化转型，强化软硬协同，加快新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用，编制重点产业链数字化转型场景图谱及要素清单，培育面向典型场景的数字化转型通用工具产品、解决方案与服务商。本项目依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级，属于信息化升级建设项目，符合国家及行业相关产业政策导向。

（2）PCB 行业数字化转型技术体系趋于成熟，项目实施风险可控

目前，PCB 行业数字化转型所涉及的生产装备联网、数据采集与监控、制造执行系统、智能质量检测、智能排产、供应链协同管理及工业互联网平台等关键技术路径较清晰，相关软硬件产品与解决方案成熟度较高，行业内已形成较为完善的技术服务与系统集成生态，头部企业数字化工厂建设与运营实践经

验丰富，技术应用具备良好的可复制性与可推广性。本项目在公司现有信息化建设基础上实施，技术选型贴合行业成熟应用方案，实施流程规范可控，项目整体技术可行性较高，实施风险可控。

（3）公司具备数字化升级建设的软硬件基础

公司依托数字化建设基础及前期数字化建设积淀，已构建覆盖生产、管理、人才的多层次数字化支撑体系，为本次数字化系统升级项目实施奠定坚实基础。生产数字化方面，公司全资子公司鹤山生产基地智能化车间获评江门市制造业数字化转型标杆示范车间；泰国生产基地在规划建设阶段即同步部署 MES、WMS 等核心数字化系统，已实现订单流转、生产过程追溯、工艺配方管控及跨境物流协同等功能，境内外基地均积累了成熟可复制的数字化建设与运营经验。管理数字化方面，公司已上线 OA、财务、人力资源等一体化管理信息系统，全面覆盖核心业务与管理职能模块；同时公司已通过 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO13485 及 ISO27001 等多项国际管理体系认证，形成标准化、规范化的管理流程，为管理数字化升级提供完备的制度保障与系统支撑。人才储备方面，公司组建专业化信息化技术团队，实施专业人才梯队培养，核心人员具备多年 PCB 行业信息系统规划、部署与运维经验，深度契合公司业务流程与经营管理需求，能够为项目全周期实施提供稳定可靠的专业技术保障。

4、建设内容、投资构成及测算依据

本项目预计总投资为 12,763.01 万元，拟使用募集资金投入金额 8,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元、%

序号	项目	项目资金	占比	募集资金投入金额
一	**资产投资**	**12,512.75**	**98.04**	**8,000.00**
1.1	软件购置及实施费	10,247.75	80.29	
1.2	设备购置及安装	2,195.00	17.20	
1.3	装修及配套工程费	70.00	0.55	
二	**预备费**	**250.26**	**1.96**	-
合计		**12,763.01**	**100.00**	**8,000.00**

该项目拟使用募集资金投入金额为 8,000.00 万元，募集资金主要用于项目所属的软件购置及实施费用，本次募集资金均用于董事会决议日后的项目资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出项目的情形。

该项目的投资构成、测算依据和测算过程如下：

（1）软件购置及实施费

本项目拟依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级，涉及的软件购置及实施费的价格主要参考公司拟购买设备厂商的近期初步沟通报价测算。本项目所需的软件购置及实施费投入估算金额为 10,247.75 万元。

（2）设备购置及安装

本项目涉及的设备购置及安装主要系生产数字化中 E-mapping 管理系统涉及的相关硬件设备购置及更新，相关价格主要参考公司历史设备购买价格及拟购买设备厂商的近期初步沟通报价测算。本项目所需的设备购置及安装投入估算金额为 2,195.00 万元。

（3）装修及配套工程费

装修及配套工程费主要包括公司 7 号厂房机房建设，主要依据公司本项目涉及的 7 号厂房机房建设实际情况估算确定，预计为 70.00 万元。

5、项目实施主体

本项目由母公司深圳中富电路股份有限公司及其全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司负责实施。

6、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目预计建设期为 24 个月，项目整体进度安排如下：

序号	项目	T1（年）				T2（年）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备及方案论证								

2	硬件及软件采购、安装								
3	人员招募及培训								
4	设备安装调试								
5	验收竣工								

7、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目为数字化升级建设项目，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益。本项目拟依托公司现有信息化基础，围绕生产数字化、管理数字化及供应链数字化三大方向实施数字化系统升级。项目实施后，公司将稳步提升运营管理效率、信息化水平及产品良率与质量，有利于公司构建精益制造体系，实现降本增效目标。

8、项目涉及土地、备案、环评等审批情况

截至本募集说明书签署之日，公司已于 2026 年 6 月 12 日获取深圳市宝安区发展和改革局下发的备案证书，备案编号为“深宝安发改备案(2026)1406号”。

本项目系信息化、数字化系统升级建设，不涉及产能增加，预计不会对环境产生重大影响，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的需要进行环境影响评价的类型，因此无需履行环境影响评价审批手续。

本项目系信息化、数字化系统升级建设，不涉及新增土地获取的审批。

（三）补充流动资金

1、项目概况

根据公司经营发展规划，公司拟使用募集资金 16,400.00 万元用于补充流动资金，有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

2、项目必要性和可行性

（1）项目必要性

PCB 行业属于资金密集型产业，整体资金需求较高。一方面，PCB 产品生产需配备各类专业生产及检测设备，且公司产品品类丰富、定制化属性突出，需根据产品结构、基材材质、性能要求及客户需求适配不同生产设备，设备投入需求较大；另一方面，伴随业务规模扩大与市场竞争加剧，公司在原材料采购、生产制造、市场拓展等环节的资金投入持续增加。同时，受业务模式及结算政策等因素影响，公司应收账款、存货等经营性资产规模较大，对流动资金形成一定占用。本次募投项目实施后，将有助于提升运营效率，改善公司经营性现金流状况，保障核心业务持续经营。

报告期内公司 2023 年至 2025 年的营业收入复合增长率为 23.05%，保守估计假设公司未来三年的营业收入复合增长率为 20%，同时，结合公司 2025 年末主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例情况，通过销售百分比法对 2026 年末、2027 年末和 2028 年末的经营性流动资产和经营性流动负债进行预测。根据上述对营业收入的预测，假设公司预测期内经营性流动资产及经营性流动负债占营业收入的比例保持与 2025 年度相同，则对流动资金缺口预测如下表：

单位：万元

项目	2025 年	占比	2026 年 E	2027 年 E	2028 年 E
营业收入	**187,912.99**	**-**	**225,495.59**	**270,594.71**	**324,713.65**
应收票据	7,494.97	3.99%	8,993.96	10,792.76	12,951.31
应收账款	45,350.13	24.13%	54,420.16	65,304.19	78,365.02
应收款项融资	3,532.00	1.88%	4,238.40	5,086.08	6,103.30
预付款项	150.70	0.08%	180.84	217.01	260.41
存货	57,748.88	30.73%	69,298.66	83,158.39	99,790.06
经营流动资产小计	**114,276.68**	**60.81%**	**137,132.02**	**164,558.42**	**197,470.10**
应付票据	27,449.31	14.61%	32,939.17	39,527.01	47,432.41
应付账款	57,730.19	30.72%	69,276.23	83,131.47	99,757.77
合同负债	281.16	0.15%	337.39	404.87	485.84
经营流动负债小计	**85,460.66**	**45.48%**	**102,552.79**	**123,063.35**	**147,676.02**
流动资金占用额	28,816.02	-	34,579.22	41,495.07	49,794.08
流动资金缺口					**20,978.06**

注 1：假设条件：根据 2023-2025 年营业收入复合增长率 23.05%，假定未来三年发行人营业收入复合增长率为 20%，公司未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与 2025 年的占比保持一致；

注 2：流动资金需求测算的公式如下：流动资金占用额=经营性资产-经营性负债；新增流动资金需求=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额；未来三年营运资金需求=2028 年流动资金占用额-2025 年流动资金占用额；
注 3：公司以上假设仅用于本次补充流动资金需求的测算，不作为对未来收入或资产负债金额的预测。

（2）项目可行性

本次发行部分募集资金用于补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于上市公司规范运作的相关规定，建立健全关于各项公司治理制度，并在日常生产经营活动过程中通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司对募集资金的存储、使用、管理与监督等作出了明确规定，确保公司募集资金的依法、合规使用。

三、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，经历多年沉淀积累公司具备一定的核心技术优势、研发能力优势、人才优势、客户优势和行业地位优势等，实施本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。

1、人员储备

公司组建了经验丰富的核心技术管理团队，核心人员均拥有十余年 PCB 行业研发、工艺开发、工程管理及产业化实践经历，多名骨干曾任职于国内头部 PCB 上市公司，在高速 PCB、厚铜产品、特种电源类线路板工程设计、制程研发、材料应用、信号完整性研究、新品导入及规模化生产运营等领域积淀深厚，具备 AI 服务器电源相关 PCB 产品从技术研发、工艺落地到量产实施的完整能力，为公司布局 AI 服务器电源 PCB 业务提供坚实人才支撑。

2、技术储备

公司深耕 PCB 领域多年，针对 AI 硬件高功率密度、精密散热、异构集成的核心需求，已构建起贯穿原材料加工、器件级封装至系统集成的全链条核心技术体系，在 AI 电源板精密制造、厚铜载板功率传输、埋器件系统集成等领域形成关键技术储备，相关技术已实现精密尺寸控制、小间距线路、器件嵌埋等核心突破，为本次募投项目建设及顺利实施提供了坚实的技术保障，有效保障项目技术可行性。

公司在精密制造（含 PCB 平面度、尺寸公差控制）、功率传输（厚铜线路优化）、系统集成（器件埋入）等核心技术领域已实现关键突破，相关技术已具备规模化生产条件，能够精准匹配本次募投项目高端 AI 服务器电源相关产品的技术要求，有效降低项目技术落地风险，进一步夯实项目可行性基础。如公司关于“智能三次电源连接器电路板的研究”“芯片埋入式电源模组开发”“高功率电源芯片埋入式 PCB 项目”等 AI 服务器电源专项研发项目均已完成。依托成熟的技术积淀与规模化生产经验，公司可快速实现募投项目产能释放、产品稳定交付，确保项目投产后能够顺利达成预期目标，为公司项目建设提供了坚实的技术保障。

3、市场储备

本次鹤山中富 PCB 产线改扩建项目，业务重心聚焦 AI 服务器电源 PCB 核心赛道，同时统筹布局高速通信 PCB 产能储备，产品定位贴合下游行业发展趋势，精准对接主流核心客户实际订单诉求。为了加大对 AI 用 PCB 市场的开发力度，公司陆续通过了多家知名客户的供应商认证体系认证，成功开拓了诸如台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、沛塬电子、美国芯源（MPS）等多家 AI 服务器客户，同时与多家境外大型云厂商客户及其供应商进行了富有成效的接触、试样及联合研发，参与大客户新产品预研，为本次项目的实施奠定了稳定的市场基础。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资额为 103,183.53 万元，拟使用募集资金金额为 84,400.00 万元。本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。资金缺口的来源方面，除公司自有经营利润积累以外，公司属于 PCB 行业知名上市公司，具有良好的信用记录，融资环境相对宽松，银行融资授信额度充裕。公司在募集资金不足及项目建设存在资金缺口时，自筹资金来源可行性较高，可保障募投项目的顺利实施。

四、本次发行董事会决议日距前次募集资金到账的时间间隔

公司前次可转债募集资金于 2023 年 10 月到位，距本次发行董事会决议日 2026 年 5 月间隔期已超过 18 个月；截至本次发行的董事会决议日，公司前次募集资金已全部按计划使用完毕，募集资金投向未发生变更。因此，本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资”之规定。

五、关于主营业务与募集资金投向的合规性

（一）本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，本次募集资金拟投向鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目、数字化升级建设项目及补充流动资金等项目。本次募投项目的产品为印制电路板，侧重 AI 服务器电源产品，聚焦通信及数据中心等领域，发行人主营业务和本次募投项目均不涉及高耗能高排放行业，本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业，不属于产能过剩行业，符合国家产业政策要求。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人主营业务属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3982 电子电路制造”；根据国家统计

局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人主营业务属于“1.2 电子核心产业”之“1.2.1.3982*电子电路制造”；根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），发行人产品属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.3 新型元器件”中“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”。本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

（二）本次募集资金投资项目与主业的关系

本次募集资金投向均系密切围绕公司主营业务进行，具体情况如下：

项目	鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目	数字化升级建设项目	补充流动资金
1、是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产	是，本项目系基于公司拓展 AI 服务器电源板市场、扩大主营业务规模、提高公司盈利能力而实施，本项目新增 12 万平方米/年的 AI 服务器电源 PCB 产能，侧重 AI 服务器电源板产品，聚焦通信及数据处理中心领域，属于公司对现有业务的扩产。	否	否
2、是否属于对现有业务的升级	是，本次募投项目通过以下几方面对现有业务进行升级：①产品结构升级：本次募投项目聚焦 AI 服务器电源 PCB，该等产品在单价水平、盈利空间、客户壁垒等方面较传统 PCB 相比具有较高的提升，该等业务的拓展能够提升公司高端 PCB 产品占比；②技术升级：随着公司本次对生产工艺与生产设备进行升级，公司生产上对工艺控制能力、产品质量、参数标准等要求更高，属于对现有业务技术的升级；③客户结构升级：公司已通过台达电子、伟创力、铂科新材、新雷能、美国芯源（MPS）等多家 AI 服务器电源客户的认证，与多家境外大型云厂商客户及其供应商开展接触、试样及联合研发，本次募投项目达产以后，公司将深度绑定该等客户，实现产能消化与客户结构优化升级。	是，本项目可以提高公司生产运营效率、提升产品精度控制能力，属于对公司现有生产体系的智能化、数字化升级改造。	否
3、是否属于基	否	否	否

于现有业务在其他应用领域的拓展			
4、是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸	否	否	否
5、是否属于跨主业投资	否	否	否
6、其他	无	无	无

六、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、公司战略规划方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于优化公司产能布局、扩大业务规模、增强市场竞争力，对公司开发新的客户资源、寻求新的利润增长点具有重要意义。

（二）本次募集资金对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将相应提高，资金实力将显著增强。随着本次发行的落地，公司的资产负债率将有效降低，有利于优化公司资本结构、提升公司抗风险能力。本次募集资金投资项目达到预期目标需要一定的时间，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目的实施，公司的业务规模和盈利能力将进一步提高。

第四节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金情况

（一）前次募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,396.00 万股，发行价格为每股 8.40 元，募集资金总额 369,264,000.00 元,扣除发行费用 39,542,732.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 329,721,267.94 元。募集资金已于 2021 年 8 月 6 日分别划至公司指定专户。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（大华验字[2021]000553 号）验资报告。

截至本募集说明书签署日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕并销户。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间及存放情况

经中国证监会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元。募集资金已于 2023 年 10 月 20 日存入公司指定专户。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（大华验字[2023]000617 号）验资报告。

截至本募集说明书签署日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕并销户。

（二）前次募集资金实际使用情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			32,972.13			已累计使用募集资金总额：			33,481.29	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：				
						2023 年：			7,209.97	
						2024 年：			12,321.81	
						2025 年：			13,949.51	
承诺投资项目和超募资金投向			**募集资金投资总额**			**截止日募集资金累计投资额**				**项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）**
序号	**承诺投资项目**	**实际投资项目**	**募集前承诺投资金额**	**募集后承诺投资金额**	**实际投资金额**	**募集前承诺投资金额**	**募集后承诺投资金额**	**实际投资金额**	**实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额**	
1	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	63,863.20	28,782.31	29,291.47	63,863.20	28,782.31	29,291.47	509.16	2023 年 6 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	4,189.82	4,189.82	12,000.00	4,189.82	4,189.82	-	不适用
合计			**75,863.20**	**32,972.13**	**33,481.29**	**75,863.20**	**32,972.13**	**33,481.29**	**509.16**	

注：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的 509.16 万元用于新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司的募集资金均已使用完毕，募资账户已于 2026 年 5 月全部销户，前次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：	52,000.00	已累计使用募集资金总额：	52,283.70
变更用途的募集资金总额：	不适用	各年度使用募集资金总额：	
		2023 年：	17,184.96
		2024 年：	16,614.15
		2025 年：	13,791.73
		2026 年 1-6 月：	4,692.86

承诺投资项目和超募资金投向			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产100万平方米印制线路板项目	年产100万平方米印制线路板项目	40,000.00	40,000.00	40,735.73	40,000.00	40,000.00	40,735.73	735.73	2025 年 1 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	11,532.02	11,547.97	12,000.00	11,532.02	11,547.97	15.95	不适用
合计			52,000.00	51,532.02	52,283.70	52,000.00	51,532.02	52,283.70	751.68	-

（三）募集资金变更情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

公司在实际投入过程中，受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，无法在原计划 2022 年 2 月完成建设。2022 年 4 月 26 日公司召开了第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至 2022 年 12 月 31 日；2023 年 1 月 18 日公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 6 月 30 日。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至本募集说明书签署日，实际投资项目不存在变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010849 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,644.45 万元，上述募集资金置换事项已于 2021 年 12 月 31 日前完成。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0016339 号），公司以自筹资金预先投入年产 100 万平方米印制线路板项目的实际投资金额为 3,534.49 万元，上述募集资金置换事项已于 2023 年 11 月 1 日完成。

（五）闲置募集资金的使用

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 5 月 7 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品，上述存款产品不得进行质押，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，此事项无需提交股东大会审议。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第九次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、

不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。投资品种投资期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求（结构性存款、大额存单等安全性高的产品等），不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（六）前次募集资金实现效益对照情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年		
1	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	100.00%	20,335.60	5,125.20	3,362.88	962.07	-	9,450.15	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

上述募集资金投资项目的效益未达预期的主要原因一是下游通信电子、消费电子等市场竞争加剧导致公司产品销售单价水平未达预期；二是主要原材料采购价格上涨幅度较大导致公司产品毛利率下降。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目	截止日投	承诺效	最近三年一期实际效益	截止日累	是否

序号	项目名称	资项目累计产能利用率	益	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年	计实现效益	达到预计效益
1	年产 100 万平方米印制线路板项目	34.95%	3,049.92	-4,176.73	-1,788.38	不适用	不适用	-5,965.11	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

上述募集资金投资项目的效益未达预期的主要原因系，发行人泰国子公司项目尚处于产能释放过渡期，整体产能利用率处于较低水平，厂房设备对应的折旧摊销、当地人员薪酬、运维管理等固定成本持续发生，而项目实现的主营业务收入规模有限，不足以覆盖当期发生的各项固定成本费用，进而造成项目阶段性效益不及预期。

二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项报告》（容诚专字[2026]518Z1241 号）认为，中富电路《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了中富电路公司截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的影响

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目、数字化升级建设项目以及补充流动资金，上述项目与公司的主营业务密切相关，不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，不涉及公司业务和资产的整合。本次发行将有利于增强公司资本实力，进一步提升公司的竞争优势，符合公司长远发展目标和股东利益。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次向特定对象发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。截至本募集说明书出具日，公司尚无对章程其他事项调整的计划。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行前，公司实际控制人王昌民、王璐及王先锋通过中富电子、中富兴业、睿山科技、泓锋实业、香港慧金等主体合计间接控制发行人 62.31%股份。本次发行完成后，公司股本将增加，原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司控股股东、实际控制人仍保持不变。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备在深交所的上市条件。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司高级管理人员结构不会因此发生变化。若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次向特定对象发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目、数字化升级建设项目以及补充流动资金。上述项目紧密围绕公司主营业务、顺应公司发展战略，系对公司主营业务的升级与拓展，本次发行不会导致公司业务结构发生重大变化。

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产总额将相应增加，资产负债率和财务风险将有所下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，资本规模进一步扩大。本次募集资金均投向公司主营业务，用于公司未来发展的战略布局。但由于公司募投项目的建设和生产需要一定时间，募投项目效益在短时间内无法完全体现，因此本次向特定对象发行完成后，短时间内发行人的净资产收益率及每股收益指标将被摊薄。

从长远来看，本次募集资金投资项目的实施将对公司主营业务的发展产生积极影响，有利于提升公司的综合竞争力，随着募集资金投资项目预期效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入将大幅增加，同时随着募投项目的建设，公司投资活动现金流出也将相应增加。待公司募投项目投入运营并产生效益后，公司的竞争实力不断提升，将有助于扩大公司经营活动现金流入规模。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，因此，本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本募集说明书签署日，公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，亦不存在公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被实际控制人及其关联方占用的情形，亦不会产生公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降；同时，本次发行后公司投融资能力、抗风险能力将得到提高。因此，本次发行有利于提高公司抵御风险的能力。公司不存在通过本次发行而大量增加负债以及或有负债的情况、亦不存在导致公司负债比例过低以及财务成本不合理的情况。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）募投项目实施风险

1、募投项目效益未达预期的风险

公司董事会已对本次募投项目的可行性展开充分论证。依据项目可行性研究报告，鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目在运营期内预计年均营业收入为 70,044.44 万元，年均净利润达 8,576.81 万元。该可行性分析系基于当前市场环境、既有技术水平及对行业发展趋势的判断而制定，但项目推进过程中，仍可能因宏观政策与市场环境出现不利变化、PCB 行业竞争态势加剧、关键技术发生重大迭代、新增产能消化不及预期、AI 基础设施建设节奏放缓等因素，导致募投项目延期实施或无法达到预期效益。

当前全球经济复苏前景尚存不确定性，地缘政治形势依然复杂多变。若未来下游 AI 领域需求增速不达预期，PCB 行业竞争可能进一步激化，募投项目新增产能将面临消化压力；同行业上市公司或采取降价策略争夺订单，进而压缩行业整体利润空间。此外，本次募投项目将新增较多固定资产，预计达产后新增折旧摊销金额将对公司利润水平产生一定影响。因此，若未来新增产能消化不足或产品价格下行，募投项目的效益实现将受到制约。同时，在项目实施过程中，亦可能因经营风险、意外事故或其他不可抗力因素，造成投资周期延长、成本超支、投产延迟等情况，从而引致募投项目实际收益不及预期的风险。

2、项目投产后的产能消化风险

报告期内，公司产能利用率分别为 73.18%、87.38%、82.13%和 90.49%。考虑到产线排期、设备例行检修以及新建泰国工厂尚处于产能爬坡阶段等因素，公司整体产能利用率维持在较高水平。同期，公司产品产销率分别为 98.89%、91.80%、92.24%和 95.07%，公司产品销售态势良好。由于前次可转债募投项目泰国工厂已于 2025 年初投产，尚处于产能爬坡阶段，本次募投项目投产后将新

增年产 12 万平方米印制电路板产能，公司未来产能增长较快。若 PCB 市场增速或下游客户开拓进展不及预期，则公司现有及拟建产能将面临一定的消化风险。

3、募投项目折旧摊销增加导致利润下滑的风险

本次募投项目涉及大额设备采购及建设工程等资本性支出，项目建成投产后，公司每年将新增较高金额的折旧摊销费用。根据测算，本次募投项目预计每年新增折旧摊销费用最高为 6,891.38 万元，将对公司利润总额产生一定影响。尽管公司已对募投项目进行了充分的可行性论证，并根据效益预测确认新增收益足以覆盖上述折旧摊销费用，但项目实际收益受宏观经济、产业政策、市场环境、行业竞争格局及技术迭代等多重因素影响。若未来项目效益未能达到预期水平，新增折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

4、本次募投产品技术迭代风险

AI 服务器供电架构处于快速迭代阶段，海内外供电方案持续演进，对 AI 服务器电源 PCB 在高压绝缘、厚铜载流、热管理、埋嵌工艺等方面的技术指标持续提出更高要求。本次募投项目聚焦 AI 服务器电源 PCB 产品，下游算力客户产品迭代、技术路线选择存在不确定性，若公司未能持续跟进行业技术演进节奏，研发投入不足、工艺开发或客户验证进度滞后于行业竞争对手，或对下游供电架构迭代方向判断出现偏差，将可能导致募投项目建成后的产品规格无法匹配客户最新技术需求，新增产线、设备存在技术适配性下降的风险，进而削弱相关产品市场竞争力，对募投项目效益实现及公司经营业绩造成不利影响。

（二）财务风险

1、业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 124,112.76 万元、145,398.48 万元、187,912.99 万元和 117,207.60 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2,626.93 万元、3,809.43 万元、2,914.44 万元和 3,861.86 万元。2025 年，受泰国工厂产能爬坡、研发投入加大及原材料价格上涨等因素影响，公司归母净利润

同比有所下降。公司经营业绩受下游市场需求变化影响较大，若未来宏观经济表现疲弱，相关行业政策或技术发生重大不利调整，或泰国工厂未能实现预期经济效益，抑或国际贸易摩擦、地缘政治冲突持续恶化，均可能对公司盈利能力造成较大冲击。在个别极端情形或多项风险叠加的情况下，发行人存在发行当年业绩下滑的可能性。

2、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,157.45 万元、37,941.44 万元、45,350.13 万元和 56,561.35 万元，占各期营业收入的比例依次为 24.30%、26.09%、24.13%和 24.13%（已年化处理），其中账龄一年以内的应收账款占比在 98%以上，发生坏账的风险较小。公司应收账款余额随业务规模的扩大呈不断增加的趋势，若下游客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。

3、存货规模较大及跌价风险

报告期内随着公司经营规模的扩大，公司存货规模上升较多。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 29,819.05 万元、41,452.15 万元、57,748.88 万元和 65,209.42 万元，占公司总资产的比例分别为 13.18%、13.88%、17.65%和 19.60%。2025 年末、2026 年 6 月末存货账面价值占总资产比例增加主要系公司泰国工厂新建产能增加以及原材料价格上涨所致。若未来公司主要原材料和产品价格在短期内发生大幅下降，或因国家政策和市场需求造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品难以在短期内实现销售，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值，届时需计提存货跌价准备，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、经营活动现金流净额波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,634.32 万元、6,242.06 万元、10,444.18 万元和-5,252.66 万元。2026 年上半年，公司原材料采

购规模、用工成本及相关税费以及相应采用银行承兑汇票结算的金额增加，导致公司当期经营活动现金流量净额同比下降。如果公司在未来无法采取有效措施缓解经营活动现金流压力，可能会影响公司生产经营活动的正常开展，进而对公司的持续经营和偿债能力带来不利影响。

5、汇率波动风险

公司境外销售主要采用美元结算，结算货币与人民币之间的汇率受国内外政治、经济环境影响而存在波动，具有较大不确定性。报告期内，公司汇兑损益金额分别为-219.87 万元、-77.77 万元、868.25 万元和 2,219.42 万元（负值表示汇兑收益）。考虑到公司泰国工厂产能利用率在不断提升、境外客户订单不断拓展等因素，若未来公司境外业务规模持续扩大，在汇率发生波动时，以外币计价的资产折算将产生汇兑损益，进而对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。

6、税收优惠政策变化的风险

2023 年 11 月公司通过高新技术企业复审，有效期三年。报告期内公司均享受 15%的企业所得税优惠税率。税收优惠政策期满后，如公司不能继续被认定为高新技术企业或国家主管税务机关对上述税收优惠政策作出调整，对公司经营业绩和利润水平将产生一定程度的不利影响。

7、本次发行摊薄即期股东收益的风险

报告期内，公司基本每股收益为 0.15 元/股、0.22 元/股、0.16 元/股和 0.20 元/股，加权平均净资产收益率为 2.32%、3.24%、2.08%和 2.31%。本次发行后，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在短期内每股收益、净资产收益率下降的风险。

（三）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司原材料成本占总成本比重较高，报告期内，直接材料占主营业务成本的比例约为 58.14%，其采购价格对主营业务成本具有显著影响。公司生产所需主要原材料涵盖覆铜板、铜箔、铜球、半固化片及金盐等，上述材料价格受铜、石油、黄金等大宗商品市场行情波动影响较大。近年来，受全球经济形势及国际政治局势变动影响，国际铜价、金价及石油价格出现较大幅度波动，公司主要原材料采购价格亦随之呈现明显波动。若未来主要原材料采购价格持续上涨，而公司无法通过向下游客户传导、工艺技术创新、产品结构优化等方式有效应对成本上升压力，则公司盈利水平将面临不利影响。

2、业务规模扩大导致的管理风险

报告期各期末，公司资产总额分别为 226,237.47 万元、298,624.02 万元、327,165.30 万元和 332,714.67 万元，报告期内公司营业收入分别为 124,112.76 万元、145,398.48 万元、187,912.99 万元和 117,207.60 万元，公司资产和营收规模持续扩大。本次发行完成后，公司的资产规模、经营规模将进一步提高，本次募投项目之鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目是公司在 AI 服务器电源领域的深入拓展，将在市场开拓、生产管理、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高的要求，公司将面临一定的管理风险。若公司的管理制度和管理体系无法持续满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。

3、贸易摩擦风险

公司在多年生产经营过程中积累了部分稳定的境外客户，外销收入对公司营业收入以及毛利润贡献明显。报告期内，公司主营业务收入中外销收入所占比例分别为 30.49%、27.72%、25.80%及 30.17%，产品主要出口地包括欧洲、东南亚等地区。同时，随着未来公司泰国工厂产能利用率稳步提升、承接订单量逐年增加，预计公司境外营业收入占比将不断提升。尽管目前我国已经成为全球最大的 PCB 生产基地，且具备较强的产能消化能力，但如果因贸易摩擦而导致对我国 PCB 产品采取限制政策、提高关税及其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国 PCB 行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

（四）技术风险

1、技术创新风险

公司主要从事 PCB 的研发、生产与销售，产品研发及规模化生产融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多学科技术，属于技术密集型行业。工艺的优化和升级、产品的开发和更新、产品性能的提高都依赖于创新，科技创新和产品创新对于保持和提升公司市场地位起到较为重要的作用。但由于创新存在一定的不确定性，若公司未来创新偏离客户的需求或行业发展趋势，或者创新成果转化失败，均会导致公司创新无法达到预期效果，进而对公司的竞争地位和经营业务带来不利影响。

2、核心技术人员流失风险

PCB 行业生产工艺复杂、技术难度大，需要具备对产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发，并提升产品稳定性、可靠性的能力，以帮助客户快速完成新产品开发、抢占市场先机，研发和技术人员是公司生存和发展的重要基础。若未来核心技术人员流失或未能及时引进所需人才，将会对公司业务造成不利影响。

3、研发失败的风险

报告期内，公司研发费用分别为 5,366.96 万元、7,659.77 万元、10,473.92 万元和 6,062.18 万元，占当期公司营业收入的比例分别为 4.32%、5.27%、5.57%和 5.17%。若公司在未来开发过程中出现关键技术未能突破或者产品具体指标、开发进度无法达到预期、新产品未能满足市场需求等情形，将对公司生产经营带来一定程度的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济波动风险

PCB 作为电子产品和信息基础设施不可缺少的基础电子元器件，其应用范围广泛，与全球宏观经济形势关联度较高。2023 年，由于下游需求疲软、高库

存调整等因素影响，抑制了 PCB 行业的新增需求，当年全球 PCB 产值为 695.17 亿美元，同比大幅下降 15.0%；2024 年，受汽车电子、卫星通信、AI 服务器、光通信等领域对高多层板、HDI 等产品需求大幅增加的影响，PCB 市场需求逐步回暖，全球 PCB 总产值 735.65 亿美元，同比增长 5.8%；2025 年，全球 PCB 总产值为 858.36 亿美元，同比大幅增长 16.68%。目前受贸易摩擦、地缘政治、境外通货膨胀等因素影响，国内外宏观经济形势存在不稳定因素。若未来宏观经济出现明显回落或下游行业出现周期性波动等不利因素，PCB 产业发展速度可能出现放缓或下降，对公司经营情况造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争充分。随着近年来行业内企业国际化布局加速，东南亚地区 PCB 新建产能较多，未来市场竞争可能进一步加剧，行业集中度逐步提升。经过多年积累，公司产能规模逐步扩大、营业收入不断增长，服务客户的广度和深度不断提高，但与行业龙头企业相比，公司在业务规模、市场占有率等方面仍存在一定差距。若未来下游领域需求增速不及预期，或 PCB 行业扩产产能集中释放，公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，则可能出现行业竞争加剧的情形，进而导致盈利下滑的风险。

（三）环保风险

公司 PCB 生产过程中涉及蚀刻、电镀等工序，会产生废水、废气及固体废物等污染物和噪声。公司自成立以来始终视节能环保为企业发展基石，生产期间未发生重大环境污染事故。但在生产经营过程中，无法完全排除因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故的可能性，届时可能会给周围环境造成污染，触犯环保相关的法律法规，对公司经营造成不利影响。同时，公司在环境保护方面的投入会随着新环保政策的出台而加大，在一定程度上会增加公司的运营成本。

（四）安全生产风险

PCB 企业普遍在生产过程中存在生产工序长、大型设备多、生产员工多的特点。公司高度重视安全生产管理，报告期内公司未发生重大安全事故。但如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或自然灾害等因素而造成安全生产事故，将会对公司的生产经营产生一定程度不利影响。

（五）产业政策变动风险

近年来，国家、地方陆续出台了一系列产业政策，支持和鼓励包括 PCB 在内的电子信息产业发展。但随着宏观经济环境的逐渐变动，未来阶段政策发展仍可能存在一定的不确定性，如果对 PCB 等电子行业、下游行业的产业政策支持逐步减少，则可能导致 PCB 及下游行业发展速度减缓，对公司业绩、盈利能力造成一定的不利影响。

三、其他风险

（一）审核风险

本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会的注册批复，能否获得注册批复以及最终取得相关主管部门批复的时间存在一定的不确定性。

（二）本次发行失败或募集资金不足的风险

本次募集资金将用于鹤山中富 AI 用 PCB 产线改扩建项目、数字化升级建设项目以及补充流动资金。如本次发行失败或募集资金未达到本次募投项目建设需求，公司将利用经营积累和银行融资等多种融资方式继续推进募投项目建设，在一定期间内可能造成公司资金紧张，对公司生产经营及募投项目建设存在一定影响。若未来公司自身财务状况出现重大不利变化，亦将导致项目实施存在不确定性。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

王昌民　　王 璐　　王先锋

蒋卫民　　于培友　　王 昆

除董事以外的高级管理人员：

王家强　　许亚丽　　张京荔

深圳中富电路股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

二、审计委员会声明

本公司全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员：

于培友　　王 昆　　王 璐

深圳中富电路股份有限公司

2026年 9月 22日

三、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东盖章：

中富电子有限公司

法定代表人：

王昌民

2026年 9月 22日

三、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东盖章：

深圳市睿山科技有限公司

法定代表人：

王 璐

2026 年 9 月 22日

三、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东盖章：

深圳市泓锋实业发展有限公司

法定代表人：

王先锋

2026年 9月 22日

三、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东盖章：

香港慧金投资有限公司

法定代表人：

王昌民

2026 年 9 月 22 日

三、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东盖章：

深圳市中富兴业电子有限公司

法定代表人：

王昌民

2026年9月22日

四、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：

王昌民　　王 璐　　王先锋

2026 年 9 月 22 日

五、保荐机构（主承销商）声明

（一）保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

姜雄健

保荐代表人：

杨惠元 甘 露

法定代表人：

何之江

平安证券股份有限公司

2026年 1月 22日

（二）保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：

何之江

平安证券股份有限公司

2020 年 9 月 22 日

（三）保荐机构（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

李 谦

平安证券股份有限公司

2026年 9月 22日

六、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

龚牧龙

经办律师：

王立峰 陆顺祥

北京市金杜律师事务所

2026年 9月 22日

审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的审计报告等文件不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

中国注册会计师 龚晨艳 440300680002

龚晨艳

中国注册会计师 陈金龙 441900130047

陈金龙

周军（已离职）

会计师事务所负责人：

中国注册会计师 刘维 350200020149

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 9 月 22 日

关于签字注册会计师的离职说明

本机构作为深圳中富电路股份有限公司向特定对象发行股票的审计机构，于2026年4月27日出具了容诚审字[2026]518Z1109号审计报告以及容诚审字[2026]518Z1108号内部控制审计报告，周军为上述报告签字注册会计师之一。

截止本说明出具之日，周军因个人原因已从本机构离职，因此周军无法在深圳中富电路股份有限公司本次发行声明文件中审计机构声明中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 4 月 27 日

八、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）未来十二个月内的其他股权融资计划

除本次发行外，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）本次发行摊薄即期回报的具体措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

1、不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用；同时，本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计合理的资金使用方案，规范有效地运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、提高管理水平，严格控制成本费用

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，通过建立有效的成本和费用考核体系，对采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提高公司利润率。

4、不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

（三）关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、公司控股股东相关承诺

公司控股股东根据中国证监会相关规定，就保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：

（1）不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。

（2）自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国

证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

2、公司董事、高级管理人员相关承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相

关处罚或采取相关监管措施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书之董事会声明》之盖章页）

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年 9月 22日

附表：专利

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利申请日	专利类型
1	一种改善电路板通盲不匹配的制作方法	中富电路	2016103021136	2016.05.06	发明专利
2	一种电池板及其制造方法	中富电路	2018104241077	2018.05.07	发明专利
3	一种新能源汽车集成电路板测试系统及测试方法	中富电路	2019110633249	2019.11.01	发明专利
4	基于流胶叠构的 PCB 信号损耗计算方法	中富电路	2020103980276	2020.05.12	发明专利
5	面向车载命名数据网络的共谋兴趣洪泛攻击检测方法	中富电路	202011368390X	2020.11.30	发明专利
6	一种带镂空金手指的厚铜箔矫形 FPC 及其制作工艺	鹤山中富	2017104473826	2017.06.14	发明专利
7	一种用于天线射频传输的 PCB 板及其制作方法	鹤山中富	2017104283766	2017.06.08	发明专利
8	一种印制线路板蚀刻因子 6.0 工艺	鹤山中富	2018109142383	2018.08.10	发明专利
9	用于图形转移的线路板及图形转移工艺	鹤山中富	2020108236728	2020.08.17	发明专利
10	一种电路引脚锡焊装置	鹤山中富	2020114870710	2020.12.16	发明专利
11	电路板金手指斜坡结构的制造方法和电路板金手指	鹤山中富	2021116183426	2021.12.24	发明专利
12	改善 PCB 金属化半孔披锋的方法	鹤山中富	2021116809459	2021.12.30	发明专利
13	一种热电分离基板的制作工艺、热电分离基板	鹤山中富	2025112952615	2025.09.11	发明专利
14	一种含 POFV 树脂塞孔且激光盲孔不填平的电路板制作方法	鹤山中富	2016102956998	2016.05.06	发明专利
15	一种用于 PCB 压机平整度的检测装置	中富电路	202420909020X	2024.04.28	实用新型
16	高多层错层铆合 PCB 板	中富电路	2024229933379	2024.12.05	实用新型
17	新能源车载 OBC 电源的 PCB 电路板	中富电路	2024230032814	2024.12.06	实用新型
18	PCB 内层油墨涂布装置	中富电路	2024209153317	2024.04.28	实用新型
19	导通孔检测板及半成品印刷电路板	中富电路	2016206815316	2016.07.01	实用新型
20	印刷电路板	中富电路	2016206847177	2016.07.01	实用新型
21	PCB 耐压测试装置	中富电路	2016206861812	2016.07.01	实用新型
22	机械盲钻深度测试装置	中富电路	2016206985459	2016.07.04	实用新型
23	印刷线路板内关联尺寸检测模板及其组合件	中富电路	2016207112801	2016.07.07	实用新型
24	一种印刷电路板及其	中富电路	2016207119656	2016.07.07	实用新型

	CAF 测试单元				
25	耐电压测试装置	中富电路	2017206672938	2017.06.09	实用新型
26	PCB 板通孔质量检测装置	中富电路	2017206759490	2017.06.12	实用新型
27	一种电感测试装置	中富电路	2017207027610	2017.06.15	实用新型
28	PCB 叠合装置	中富电路	2017207999576	2017.07.04	实用新型
29	电镀光剂添加装置及系统	中富电路	2019210627239	2019.07.09	实用新型
30	PCB 层压结构及 PCB 板	中富电路	2019210671994	2019.07.09	实用新型
31	PCB 板防爆结构及 PCB 板	中富电路	2019210703321	2019.07.09	实用新型
32	导气底板	中富电路	2019210777490	2019.07.10	实用新型
33	PCB 层压结构及 PCB 板	中富电路	2019211334220	2019.07.18	实用新型
34	一种具有蚀刻均匀性检测的 PCB 电路板	中富电路	2019215843535	2019.09.23	实用新型
35	一种电路板蚀刻膜渣处理设备	中富电路	2019215843662	2019.09.23	实用新型
36	一种具有防错层的多层 PCB 电路板	中富电路	2019215843713	2019.09.23	实用新型
37	一种电路板阻焊挡点菲林	中富电路	2019215843728	2019.09.23	实用新型
38	一种红外线排板对位装置	中富电路	2021232078306	2021.12.20	实用新型
39	一种用于多层线路板压合固定的铆钉	中富电路	2021232108566	2021.12.20	实用新型
40	一种铝基电路板	中富电路	2021232108693	2021.12.20	实用新型
41	一种超薄线路板导胶压合工具	中富电路	2021232610069	2021.12.23	实用新型
42	一种压合排气工具	中富电路	2021232610938	2021.12.23	实用新型
43	一种可以横向移动的电镀边条	中富电路	2021232611199	2021.12.23	实用新型
44	一种 PCB 显影速度检测冲孔板	中富电路	2022204176366	2022.02.28	实用新型
45	一种阶梯金手指结构	中富电路	202220433556X	2022.03.01	实用新型
46	一种 HDI 板	中富电路	2022216423025	2022.06.29	实用新型
47	镍钯金制程中的自动水洗槽	中富电路	2022217924435	2022.07.12	实用新型
48	一种用于多层电源板的台阶铆钉	中富电路	2023208067998	2023.04.03	实用新型
49	一种全自动高精度切片研磨机	中富电路	2023214746604	2023.06.09	实用新型
50	一种线路良率提高的多层 PCB 板	中富电路	2023214774820	2023.06.09	实用新型
51	一种单侧阻热的 PCB 板结构	中富电路	2023216886159	2023.06.30	实用新型
52	一种基于微电阻测试的 PCB 板质量检测装置	中富电路	2023221102033	2023.08.07	实用新型
53	一种固定稳定的 PCB 板喷锡工艺中的专用夹具	中富电路	2023221102226	2023.08.07	实用新型

54	一种用于 PCB 板排版的多层板材隔离防错位定位结构	中富电路	202323100327X	2023.11.16	实用新型
55	埋入元器件的 PCB 结构、预压合件和设备	鹤山中富	2023231652608	2023.11.22	实用新型
56	具有报废标识的 PCB 高层线路板	中富电路	2023231833618	2023.11.23	实用新型
57	具有冲孔精度靶标的 PCB 高多层线路板	中富电路	2023231849029	2023.11.23	实用新型
58	用于对打靶精度量化的 PCB 标准板	中富电路	2023231869145	2023.11.23	实用新型
59	具有金属化半槽孔的 PCB 线路板	中富电路	2023232380954	2023.11.29	实用新型
60	用于 PCB 板夹持的防掉涂布夹具	中富电路	2023232578185	2023.11.29	实用新型
61	具有内层金手指引线的 PCB 板	中富电路	2023232581277	2023.11.30	实用新型
62	电路板结构或封装结构及模具	中富电路	2024207733021	2024.04.15	实用新型
63	一种多层 PCB 板压合的铆钉固定结构	中富电路	2024208984987	2024.04.26	实用新型
64	PCB 喷锡板降温设备	中富电路	2024209006248	2024.04.28	实用新型
65	一种带有长短金手指的 PCB 板	中富电路	2024209010578	2024.04.28	实用新型
66	一种金属基电源模块 PCB 板的夹板结构	中富电路	2024209012817	2024.04.26	实用新型
67	一种防漏 V-CUT 的测试结构	中富电路	2024209344742	2024.04.26	实用新型
68	一种用于 PCB 开路缺口无痕修复装置	中富电路	2024221799511	2024.09.05	实用新型
69	新能源车载电源 PCB 板冲孔装置	中富电路	2024221802764	2024.09.05	实用新型
70	一种用于 PCB 金手指上锡用的喷锡机构	中富电路	2024222055195	2024.09.09	实用新型
71	一种 PCB 压机温度测试装置	中富电路	2024222072877	2024.09.09	实用新型
72	一种用于高导热金属基电源模块 PCB 板的防刮伤喷锡挂料夹	中富电路	2024222074478	2024.09.09	实用新型
73	一种 PCB 油墨百格测试 PAD 装置	中富电路	2024222105955	2024.09.09	实用新型
74	一种用于 PCB 金手指插排定位精度模具	中富电路	2024222133828	2024.09.09	实用新型
75	一种改善 PCB 压合铜箔起皱的装置	中富电路	2024222156764	2024.09.09	实用新型
76	一种埋入式元器件	惠州铂科新感技术有限公司、中富	2025203709598	2025.03.05	实用新型

		电路			
77	一种平面变压器共模噪声全自动测试设备	鹤山中富	2025211296370	2025.06.04	实用新型
78	一种具有手撕引线设计的PCB	鹤山中富	2019213276427	2019.08.15	实用新型
79	一种控深带 R 角的半挠性板	鹤山中富	2019213400903	2019.08.16	实用新型
80	一种埋磁芯印刷线路板	鹤山中富	2019213467000	2019.08.19	实用新型
81	一种丝印钉床	鹤山中富	2019213554066	2019.08.15	实用新型
82	一种印刷线路板油墨入孔快速检测模具	鹤山中富	2019213605180	2019.08.20	实用新型
83	一种选择性镀金与喷锡结合的印刷电路板及胶层印刷网	鹤山中富	2019213718583	2019.08.22	实用新型
84	一种四阶 HDI 板	鹤山中富	2019213948316	2019.08.23	实用新型
85	用于医疗检测的 PCB 板	鹤山中富	202021708497X	2020.08.17	实用新型
86	厚铜线路板阻焊结构	鹤山中富	2020217084984	2020.08.17	实用新型
87	龙门架 PCB 板加工装置	鹤山中富	2021230710876	2021.12.08	实用新型
88	一种印制电路板	鹤山中富	2021230872423	2021.12.09	实用新型
89	PCB 板	鹤山中富	202123112604X	2021.12.10	实用新型
90	防药水交叉污染的清洗装置	鹤山中富	202123126108X	2021.12.13	实用新型
91	一种沉铜子篮	鹤山中富	2021232015504	2021.12.17	实用新型
92	防止不清理喷锡风刀装置	鹤山中富	202123453251X	2021.12.31	实用新型
93	一种用于钻机刀盘快速拆装钻咀的工装	鹤山中富	2023207688657	2023.04.07	实用新型
94	一种便于检测碳膜阻值的PCB 板	鹤山中富	2023232250185	2023.11.28	实用新型
95	防失效的适配器磁芯	鹤山中富	2023232250397	2023.11.28	实用新型
96	一种具有风干装置的插板车	鹤山中富	202320768852X	2023.04.07	实用新型
97	电镀生产设备	鹤山中富	2023208899693	2023.04.19	实用新型
98	电路板微蚀装置	鹤山中富	202321012232X	2023.04.27	实用新型
99	一种电镀安全装置及电镀线	鹤山中富	2023211714974	2023.05.15	实用新型
100	飞钯保护装置	鹤山中富	2023211763237	2023.05.15	实用新型
101	用于超声波清洗检测的夹具	鹤山中富	2023211763519	2023.05.15	实用新型
102	用于监测电镀线震动情况的装置以及电镀线	鹤山中富	2023234257174	2023.12.14	实用新型
103	一种用于电路板阻焊油墨塞孔的导气板	鹤山中富	2024223577328	2024.09.26	实用新型
104	一种改善阻焊半塞孔工艺沉锡板孔口色差的装置	鹤山中富	2024223577332	2024.09.26	实用新型
105	一种铜箔压合设备	鹤山中富	2024224102858	2024.10.08	实用新型

106	一种用于 PCB 板烘烤的上料装置及烘烤机	鹤山中富	2024230963356	2024.12.16	实用新型
107	一种 PCB 板加工用的倒角刀具、倒角装置、机床	鹤山中富	2024230992109	2024.12.16	实用新型
108	龙门电镀线	鹤山中富	2024201078835	2024.01.16	实用新型
109	一种用于覆铜板水膜测试的装置	鹤山中富	2025200204619	2025.01.06	实用新型
110	一种用于小尺寸 PCB 芯板棕化的工装及棕化设备	鹤山中富	2025202654723	2025.02.19	实用新型
111	一种铝基板	鹤山中富	2025201957076	2025.02.08	实用新型
112	一种压合排板设备	鹤山中富	2025201957112	2025.02.08	实用新型
113	一种用于医疗检测所用的 PCB 板	鹤山中富	2017206644849	2017.06.08	实用新型
114	一种用于天线射频传输的 PCB 板	鹤山中富	2017206645019	2017.06.08	实用新型
115	一种电金干膜保护装置	鹤山中富	2017206645023	2017.06.08	实用新型
116	一种高效散热金属基板	鹤山中富	2017206732252	2017.06.09	实用新型
117	一种新型阻抗条的结构	鹤山中富	2017206732318	2017.06.09	实用新型
118	一种用于龙门电镀线的摆幅监控装置	鹤山中富	2017206743435	2017.06.09	实用新型
119	一种用于 PCB 生产的自动补水装置	鹤山中富	201720674344X	2017.06.09	实用新型
120	一种印刷线路板绿油检测装置	鹤山中富	2017206938575	2017.06.14	实用新型
121	一种内嵌有无源器件的 PCB 结构	鹤山中富	2017206938607	2017.06.14	实用新型
122	一种可拉伸的 FPC	鹤山中富	2017206938838	2017.06.14	实用新型
123	一种带镂空金手指的厚铜箔矫形 FPC	鹤山中富	2017206938927	2017.06.14	实用新型
124	一种具有镀金引线内层走线结构的 PCB	鹤山中富	2018213054253	2018.08.13	实用新型
125	一种镀金夹棍夹具的螺钉防掉装置	鹤山中富	2018214311851	2018.08.31	实用新型
126	一种新型印制电路板	鹤山中富	2018214352654	2018.08.31	实用新型
127	一种内埋焊盘二阶 HDI 软硬结合板	鹤山中富	2018214359352	2018.08.31	实用新型
128	一种半挠性板	鹤山中富	2018214386082	2018.08.31	实用新型
129	电镀装置	鹤山中富	2021230586737	2021.12.07	实用新型
130	对称结构的天线板	鹤山中富	2021230738301	2021.12.08	实用新型
131	一种龙门电镀线防呆装置	鹤山中富	2021231379363	2021.12.14	实用新型
132	嵌铜柱 PCB 板	鹤山中富	2021232692270	2021.12.22	实用新型
133	PCB 装夹机构、PCB 加工系统及 PCB 测试系统	鹤山中富	2021233495848	2021.12.28	实用新型
134	PCB 曝光机的辅助装置	鹤山中富	2021234342106	2021.12.30	实用新型